

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制



苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的
晶艺半导体有限公司股东全部权益价值
资产评估报告

金证评报字【2026】A0554 号
(共一册, 第一册)



金证（上海）资产评估有限公司

2026 年 08 月 05 日

中国资产评估协会

资产评估业务报告备案回执

报告编码：	3132020024202600433
合同编号：	金证合同字【2026】A04018号
报告类型：	法定评估业务资产评估报告
报告文号：	金证评报字【2026】A0554号
报告名称：	苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的晶艺半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告
评估结论：	1,650,000,000.00元
评估报告日：	2026年08月05日
评估机构名称：	金证（上海）资产评估有限公司
签名人员：	蒋霄骑（资产评估师） 正式会员 编号：31220008 冯赛平（资产评估师） 正式会员 编号：31200002
蒋霄骑、冯赛平已实名认证	
 (可扫描二维码查询备案业务信息)	

说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为协会对该报告认证、认可的依据，也不作为资产评估机构及其签字资产评估专业人员免除相关法律责任的依据。

备案回执生成日期：2026年08月05日

ICP备案号京ICP备2020034749号

目 录

声 明.....	2
摘 要.....	3
正 文.....	5
一、 委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况	5
二、 评估目的	28
三、 评估对象和评估范围	28
四、 价值类型	35
五、 评估基准日	35
六、 评估依据	35
七、 评估方法	37
八、 评估程序实施过程 and 情况	46
九、 评估假设	47
十、 评估结论	48
十一、 特别事项说明	51
十二、 资产评估报告使用限制说明	52
十三、 资产评估报告日	53
附 件.....	55

声 明

一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。

二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定及本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估师不承担责任。

本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正确理解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评估准则，坚持独立、客观和公正的原则，并对所出具的资产评估报告依法承担责任。

四、评估对象涉及的资产和负债清单、未来收益预测资料由委托人、被评估单位申报并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相关当事人依法对其提供资料的真实性、完整性、合法性负责。

五、本资产评估机构及资产评估师与资产评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当事人没有现存或者预期的利益关系，对相关当事人不存在偏见。

六、资产评估师已经对资产评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；已经对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所涉及资产的法律权属资料进行了查验，对已经发现的问题进行了如实披露，并且已提请委托人及其他相关当事人完善产权以满足出具资产评估报告的要求。

七、本资产评估机构出具的资产评估报告中的分析、判断和结果受资产评估报告中假设和限制条件的限制，资产评估报告使用人应当充分考虑资产评估报告中载明的假设、限制条件、特别事项说明及其对评估结论的影响。

苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的
晶艺半导体有限公司股东全部权益价值

资产评估报告

摘 要

特别提示：本摘要内容摘自资产评估报告正文，欲了解本评估业务的详细情况和正确理解评估结论，应当阅读资产评估报告正文。

金证（上海）资产评估有限公司接受苏州锴威特半导体股份有限公司的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法及市场法，按照必要的评估程序，对晶艺半导体有限公司股东全部权益在 2026 年 02 月 28 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况摘要如下：

委托人：苏州锴威特半导体股份有限公司。

被评估单位：晶艺半导体有限公司。

经济行为：根据《苏州锴威特半导体股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》，苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买晶艺半导体有限公司 100% 股权。

评估目的：发行股份及支付现金购买资产。

评估对象：晶艺半导体有限公司的股东全部权益价值。

评估范围：晶艺半导体有限公司的全部资产和负债，包括流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产及负债。母公司报表总资产账面价值 519,269,595.07 元，总负债账面价值 158,753,879.76 元，所有者权益账面价值 360,515,715.31 元。合并总资产账面价值 564,557,548.00 元，合并总负债账面价值 156,381,832.39 元，合并所有者权益账面价值 408,175,715.61 元，归属于母公司所有者权益账面价值 408,175,715.61 元。

价值类型：市场价值。

评估基准日：2026 年 02 月 28 日。

评估方法：资产基础法及市场法。

评估结论：本评估报告选取市场法评估结果作为评估结论。经市场法评估，被评估单位股东全部权益于评估基准日的市场价值为人民币 165,000.00 万元，大写壹拾陆亿伍仟万元整。

评估结论使用有效期：为评估基准日起壹年，即有效期至 2027 年 02 月 27 日截止。

特别事项说明：本次评估涉及知识产权出质等可能影响评估结论的特别事项，详见本报告正文的“特别事项说明”部分。

苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产所涉及的 晶艺半导体有限公司股东全部权益价值

资产评估报告

正文

苏州锴威特半导体股份有限公司：

金证（上海）资产评估有限公司接受贵方的委托，按照法律、行政法规和资产评估准则的规定，坚持独立、客观和公正的原则，采用资产基础法及市场法，按照必要的评估程序，对苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产之经济行为所涉及的晶艺半导体有限公司股东全部权益在 2026 年 02 月 28 日的市场价值进行了评估。现将资产评估情况报告如下：

一、委托人、被评估单位和其他资产评估报告使用人概况

（一）委托人

企业名称：苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”）

企业类型：股份有限公司（上市）

证券代码：688693.SH

住 所：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢 01 室

法定代表人：罗寅

注册资本：人民币 7368.4211 万元

经营范围：半导体分立器件、集成电路和系统模块的生产、设计、测试、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；软件设计、开发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）被评估单位

1. 基本情况

企业名称：晶艺半导体有限公司（以下简称“晶艺半导体”、“公司”、“标的公司”）

企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

住 所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段 1777 号 7 栋 1 单元 15 层 1501 号

法定代表人：易坤

注册资本：人民币 5333.4111 万元

经营范围：计算机系统集成；集成电路及模块、半导体器件专用设备、电子产品设计、研发、销售并提供技术服务、技术咨询、技术转让；货物及技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 历史沿革

（1）公司设立

2018 年 12 月 18 日，晶格微、晶格未来、上海巨鱼、一方贸易、YA XU、谭清、凌风、深圳模数共同签署《晶艺半导体有限公司章程》，约定共同以货币方式出资设立晶艺半导体有限公司，设立时注册资本为 5,000 万元。

公司成立时的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	晶格未来	1,450.00	29.00
2	晶格微	1,100.00	22.00
3	上海巨鱼	900.00	18.00
4	一方贸易	700.00	14.00
5	YA XU	525.00	10.50
6	谭清	250.00	5.00
7	凌风	50.00	1.00
8	深圳模数	25.00	0.50
合计		5,000.00	100.00

注：根据《晶艺半导体有限公司投资协议》，上述股东中，除晶格未来、晶格微外的其他股东均为投资方股东。其中，一方贸易持有的 8% 股权系为新的投资人进入预留的股权。

（2）第一次股权转让

2019 年 6 月 25 日，晶艺半导体召开董事会，全体董事一致同意：原股东一方贸易将其所持晶艺半导体 50 万元出资额（占比 1%，未实缴）以 0 元的价格转让给融芯科技，并约定相应股权的出资义务由融芯科技履行。其他股东一致同意放弃优先购买权。同日，一方贸易与融芯科技签署《股权转让协议》。

2019 年 7 月 5 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	晶格未来	1,450.00	29.00
2	晶格微	1,100.00	22.00
3	上海巨鱼	900.00	18.00

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
4	一方贸易	650.00	13.00
5	YA XU	525.00	10.50
6	谭清	250.00	5.00
7	凌风	50.00	1.00
8	融芯科技	50.00	1.00
9	深圳模数	25.00	0.50
合计		5,000.00	100.00

注：一方贸易持有的7%股权系为新的投资人进入预留的股权。

(3) 第二次股权转让

2021年7月14日，晶艺半导体召开董事会，全体董事一致同意下述股权转让事项，其他股东一致同意放弃优先购买权。本次股权转让的具体情况如下：

转让方	受让方	转让出资额(万元)	转让对价(万元)
一方贸易	益方众诚	300.00(实缴)	300.00
	谭清	150.00(未实缴)	0.00
	上海巨鱼	200.00(未实缴)	0.00
晶格未来	晶格共智	600.00(实缴 306.84)	306.84
	晶格共创	225.00(实缴)	225.00
	晶格共赢	215.00(实缴)	215.00
	晶格顶峰	210.00(实缴)	210.00

同日，相关股权转让双方签署了《股权转让协议》。本次晶格未来与晶格共智、晶格共创、晶格共赢、晶格顶峰之间的股权转让系增加晶艺半导体员工持股平台。一方贸易与益方众诚之间的股权转让系同一控制下的内部调整。一方贸易与谭清、上海巨鱼之间的股权转让系预留给投资人的股权的再次分配，因未实缴出资，故相关方未实际支付对价，由受让方承继实缴出资义务。本次股权转让完成后，一方贸易设立时预留的投资人股权均分配完毕。2021年7月16日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	晶格微	1,100.00	22.00
2	上海巨鱼	1,100.00	22.00
3	晶格共智	600.00	12.00
4	YA XU	525.00	10.50
5	谭清	400.00	8.00
6	益方众诚	300.00	6.00
7	晶格共创	225.00	4.50
8	晶格共赢	215.00	4.30
9	晶格顶峰	210.00	4.20

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
10	晶格未来	200.00	4.00
11	凌风	50.00	1.00
12	融芯科技	50.00	1.00
13	深圳模数	25.00	0.50
合计		5,000.00	100.00

(4) 第三次股权转让

2021年8月30日,晶艺半导体召开董事会,全体董事一致同意:原股东谭清将其所持公司注册资本400万元(占比8%,实缴249.820779万元,150.179221万元未实缴)以0元的价格转让给其丈夫曾鸣。其他股东放弃优先购买权。同日,谭清与曾鸣签署了《股权转让协议》。

2021年8月30日,晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次股权转让完成后,晶艺半导体的股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	晶格微	1,100.00	22.00
2	上海巨鱼	1,100.00	22.00
3	晶格共智	600.00	12.00
4	YAXU	525.00	10.50
5	曾鸣	400.00	8.00
6	益方众诚	300.00	6.00
7	晶格共创	225.00	4.50
8	晶格共赢	215.00	4.30
9	晶格顶峰	210.00	4.20
10	晶格未来	200.00	4.00
11	凌风	50.00	1.00
12	融芯科技	50.00	1.00
13	深圳模数	25.00	0.50
合计		5,000.00	100.00

(5) 第一次增资(注册资本增至5,102.0408万元)

2022年4月19日,晶艺半导体召开董事会,全体董事一致同意:(1)公司注册资本由5,000万元增加至5,102.0408万元,新增的102.0408万元注册资本由新股东美的投资6,000万元以货币形式认缴;(2)公司最高权力机构变更为股东会。同日,晶艺半导体召开股东会,全体股东一致同意本次增资事项,其他股东一致同意放弃优先购买权。本次增资价格为58.80元/1元注册资本。

2022年5月18日,晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次增资完成后,晶艺半导体的股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	晶格微	1,100.0000	21.5600

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
2	上海巨鱼	1,100.0000	21.5600
3	晶格共智	600.0000	11.7600
4	YA XU	525.0000	10.2900
5	曾鸣	400.0000	7.8400
6	益方众诚	300.0000	5.8800
7	晶格共创	225.0000	4.4100
8	晶格共赢	215.0000	4.2140
9	晶格顶峰	210.0000	4.1160
10	晶格未来	200.0000	3.9200
11	美的投资	102.0408	2.0000
12	凌风	50.0000	0.9800
13	融芯科技	50.0000	0.9800
14	深圳模数	25.0000	0.4900
合计		5,102.0408	100.0000

(6) 晶艺半导体吸收合并晶格微

2022年12月9日,晶艺半导体召开股东会,全体股东一致同意:晶艺半导体吸收合并晶格微,合并后晶艺半导体为存续公司,晶格微注销。晶艺半导体和晶格微的债权债务由合并后存续的晶艺半导体承担。同日,晶艺半导体与晶格微签署《合并协议》。经核查,晶格微被吸收合并前注册资本为1,100万元,股东易坤、李伊珂、曾浩分别持有其63.63%、31.82%、4.55%的股权。

2023年4月6日,晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次股权变更完成后,晶艺半导体的股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海巨鱼	1,100.0000	21.5600
2	易坤	699.9300	13.7186
3	晶格共智	600.0000	11.7600
4	YA XU	525.0000	10.2900
5	曾鸣	400.0000	7.8400
6	李伊珂	350.0200	6.8604
7	益方众诚	300.0000	5.8800
8	晶格共创	225.0000	4.4100
9	晶格共赢	215.0000	4.2140
10	晶格顶峰	210.0000	4.1160
11	晶格未来	200.0000	3.9200
12	美的投资	102.0408	2.0000
13	曾浩	50.0500	0.9810
14	凌风	50.0000	0.9800
15	融芯科技	50.0000	0.9800
16	深圳模数	25.0000	0.4900

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
	合计	5,102.0408	100.0000

(7) 第二次增资(注册资本增至 5,386.2974 万元)

2023 年 10 月 11 日,晶艺半导体召开股东会,全体股东一致同意公司注册资本由 5,102.0408 万元增加至 5,386.2974 万元,新增的 284.2566 万元注册资本由 6 名新股东以货币形式认缴,其中高鹏翼盛投资 7,800 万元认缴 113.7026 万元注册资本;高鹏联盛投资 2,200 万元认缴 32.07 万元注册资本;腾元投资投资 1,000 万元认缴 14.5773 万元注册资本;天利投资投资 2,000 万元认缴 29.1545 万元注册资本;易荣坤投资 1,500 万元认缴 21.8659 万元注册资本;润科上海投资 5,000 万元认缴 72.8863 万元注册资本。本次增资价格为 68.60 元/1 元注册资本。

2023 年 10 月 12 日,晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次增资完成后,晶艺半导体的股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海巨鱼	1,100.0000	20.4222
2	易坤	699.9300	12.9946
3	晶格共智	600.0000	11.1394
4	YA XU	525.0000	9.7470
5	曾鸣	400.0000	7.4263
6	李伊珂	350.0200	6.4983
7	益方众诚	300.0000	5.5697
8	晶格共创	225.0000	4.1773
9	晶格共赢	215.0000	3.9916
10	晶格顶峰	210.0000	3.8988
11	晶格未来	200.0000	3.7131
12	高鹏翼盛	113.7026	2.1110
13	美的投资	102.0408	1.8945
14	润科上海	72.8863	1.3532
15	曾浩	50.0500	0.9292
16	凌风	50.0000	0.9283
17	融芯科技	50.0000	0.9283
18	高鹏联盛	32.0700	0.5954
19	天利投资	29.1545	0.5413
20	深圳模数	25.0000	0.4641
21	易荣坤	21.8659	0.4060
22	腾元投资	14.5773	0.2706
	合计	5,386.2974	100.0000

(8) 第四次股权转让

2024年7月18日,晶艺半导体召开股东会,全体股东一致同意:原股东易坤、李伊珂、YA XU 将其合计所持晶艺半导体 93.4439 万元出资额(占比 1.7348%)以合计 5,000 万元的价格转让给上海芯璿。其他股东一致同意放弃优先购买权。

2024年6月12日,易坤、李伊珂、YA XU 与上海芯璿共同签署了《关于晶艺半导体有限公司之股权转让协议》。

2024年8月15日,晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次股权转让完成后,晶艺半导体的股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海巨鱼	1,100.0000	20.4222
2	易坤	644.4866	11.9653
3	晶格共智	600.0000	11.1394
4	YA XU	514.7212	9.5561
5	曾鸣	400.0000	7.4263
6	李伊珂	322.2983	5.9837
7	益方众诚	300.0000	5.5697
8	晶格共创	225.0000	4.1773
9	晶格共赢	215.0000	3.9916
10	晶格顶峰	210.0000	3.8988
11	晶格未来	200.0000	3.7131
12	高鹏翼盛	113.7026	2.1110
13	美的投资	102.0408	1.8945
14	上海芯璿	93.4439	1.7348
15	润科上海	72.8863	1.3532
16	曾浩	50.0500	0.9292
17	凌风	50.0000	0.9283
18	融芯科技	50.0000	0.9283
19	高鹏联盛	32.0700	0.5954
20	天利投资	29.1545	0.5413
21	深圳模数	25.0000	0.4641
22	易荣坤	21.8659	0.4060
23	腾元投资	14.5773	0.2706
合计		5,386.2974	100.0000

(9) 第一次减资(注册资本减至 5,313.4111 万元)

2024年10月31日,晶艺半导体召开股东会,全体股东一致同意晶艺半导体注册资本由 5,386.2974 万元减少至 5,313.4111 万元,润科上海减少 72.8863 万元注册资本并退出晶艺半导体。

2024年11月1日,晶艺半导体与润科上海签署了《减资协议》。

2024年12月18日,晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次减资完成后,晶艺半导体的股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	上海巨鱼	1,100.0000	20.7023
2	易坤	644.4866	12.1294
3	晶格共智	600.0000	11.2922
4	YAXU	514.7212	9.6872
5	曾鸣	400.0000	7.5281
6	李伊珂	322.2983	6.0658
7	益方众诚	300.0000	5.6461
8	晶格共创	225.0000	4.2346
9	晶格共赢	215.0000	4.0464
10	晶格顶峰	210.0000	3.9523
11	晶格未来	200.0000	3.7641
12	高鹏翼盛	113.7026	2.1399
13	美的投资	102.0408	1.9204
14	上海芯珪	93.4439	1.7586
15	曾浩	50.0500	0.9420
16	凌风	50.0000	0.9410
17	融芯科技	50.0000	0.9410
18	高鹏联盛	32.0700	0.6036
19	天利投资	29.1545	0.5487
20	深圳模数	25.0000	0.4705
21	易荣坤	21.8659	0.4115
22	腾元投资	14.5773	0.2743
合计		5,313.4111	100.0000

(10) 第五次股权转让

2025年12月16日,晶艺半导体召开股东会,全体股东一致同意如下股权转让事项,其他股东一致同意放弃优先购买权。本次股权转让的具体情况如下:

转让方	受让方	转让出资额(万元)	持股比例(%)	转让对价(万元)
李伊珂	高鹏翼盛	322.2983	6.0658	3,948.8041
益方众诚	高鹏翼盛	300.0000	5.6461	3,675.6049
深圳模数	高鹏翼盛	25.0000	0.4705	306.3004
	高鹏翼盛	74.9309	1.4102	918.0546
	高鹏联盛	203.7059	3.8338	2,495.8080
	腾元投资	92.5938	1.7426	1,134.4608
上海巨鱼	华天集团	185.1871	3.4853	2,268.9154
	芯联启辰	404.6920	7.6164	4,958.2930
	陈艺琴	138.8903	2.6140	1,701.6862
合计		1,747.2983	32.8847	21,407.9274

2025年12月25日,晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次股权转让完成后,晶艺半导体的股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	高鹏翼盛	835.9318	15.7325
2	易坤	644.4866	12.1294
3	晶格共智	600.0000	11.2922
4	YAXU	514.7212	9.6872
5	芯联启辰	404.6920	7.6164
6	曾鸣	400.0000	7.5281
7	高鹏联盛	235.7759	4.4374
8	晶格共创	225.0000	4.2346
9	晶格共赢	215.0000	4.0464
10	晶格顶峰	210.0000	3.9523
11	晶格未来	200.0000	3.7641
12	华天集团	185.1871	3.4853
13	陈艺琴	138.8903	2.6140
14	腾元投资	107.1711	2.0170
15	美的投资	102.0408	1.9204
16	上海芯珪	93.4439	1.7586
17	曾浩	50.0500	0.9420
18	凌风	50.0000	0.9410
19	融芯科技	50.0000	0.9410
20	天利投资	29.1545	0.5487
21	易荣坤	21.8659	0.4115
合计		5,313.4111	100.0000

(11) 第三次增资(注册资本增至 5,333.4111 万元)

2025 年 12 月 26 日,晶艺半导体召开股东会,全体股东一致同意晶艺半导体注册资本由 5,313.4111 万元增加至 5,333.4111 万元,新增的 20 万元注册资本由原股东易坤投资 151.2 万元以货币形式认缴 20 万元。

2026 年 1 月 5 日,晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次增资完成后,晶艺半导体的股东及其持股情况如下:

序号	股东名称	注册资本(万元)		实缴资本(万元)	
		金额	占比	金额	占比
1	高鹏翼盛	835.9318	15.6735	835.9318	15.7325
2	易坤	664.4866	12.4589	644.4866	12.1294
3	晶格共智	600.0000	11.2498	600.0000	11.2922
4	YAXU	514.7212	9.6509	514.7212	9.6872
5	芯联启辰	404.6920	7.5879	404.6920	7.6164
6	曾鸣	400.0000	7.4999	400.0000	7.5281
7	高鹏联盛	235.7759	4.4207	235.7759	4.4374
8	晶格共创	225.0000	4.2187	225.0000	4.2346
9	晶格共赢	215.0000	4.0312	215.0000	4.0464

序号	股东名称	注册资本(万元)		实缴资本(万元)	
		金额	占比	金额	占比
10	晶格顶峰	210.0000	3.9374	210.0000	3.9523
11	晶格未来	200.0000	3.7499	200.0000	3.7641
12	华天集团	185.1871	3.4722	185.1871	3.4853
13	陈艺琴	138.8903	2.6042	138.8903	2.6140
14	腾元投资	107.1711	2.0094	107.1711	2.0170
15	美的投资	102.0408	1.9132	102.0408	1.9204
16	上海芯璵	93.4439	1.7520	93.4439	1.7586
17	曾浩	50.0500	0.9384	50.0500	0.9420
18	融芯科技	50.0000	0.9375	50.0000	0.9410
19	凌风	50.0000	0.9375	50.0000	0.9410
20	天利投资	29.1545	0.5466	29.1545	0.5487
21	易荣坤	21.8659	0.4100	21.8659	0.4115
合计		5,333.4111	100.0000	5,313.4111	100.0000

基准日股东释义：晶格共智（成都晶格共智企业管理中心（有限合伙）），晶格共创（成都晶格共创企业管理中心（有限合伙）），晶格共赢（成都晶格共赢企业管理中心（有限合伙）），晶格顶峰（成都晶格顶峰企业管理中心（有限合伙）），晶格未来（成都晶格未来企业管理中心（有限合伙）），晶艺求精（成都晶艺求精企业管理中心（有限合伙）），晶艺共治（成都晶艺共治企业管理中心（有限合伙）），融芯科技（深圳市融芯科技有限公司），高鹏翼盛（天津赛富高鹏翼盛企业管理合伙企业（有限合伙）），高鹏联盛（天津赛富高鹏联盛企业管理合伙企业（有限合伙）），腾元投资（嘉兴腾元投资合伙企业（有限合伙）），芯联启辰（上海芯联启辰私募投资基金合伙企业（有限合伙）），华天集团（天水华天电子集团股份有限公司），天利投资（西安天利投资合伙企业（有限合伙））。

历史股东释义：晶格微（成都晶格微科技有限公司），上海巨鱼（上海巨鱼企业管理合伙企业（有限合伙）），一方贸易（济南市一方贸易有限责任公司），益方众诚（济南益方众诚投资管理合伙企业（有限合伙）），美的投资（广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙）），润科上海（润科（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）），上海芯璵（上海芯璵企业管理合伙企业（有限合伙））。

截至评估基准日 2026 年 02 月 28 日，晶艺半导体有限公司之股权结构未再发生变化。评估基准日后截至报告出具日，被评估单位存在如下股权变动情况：

（12）第二次减资（注册资本减至 5,002.7596 万元）

2026 年 1 月 6 日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意晶艺半导体注册资本由 5,333.4111 万元减少至 5,002.7596 万元，其中：美的投资减少 102.0408 万元注册资本并退出晶艺半导体；天利投资减少 21.8659 万元注册资本；高鹏翼盛减少 85.2770 万元注册资本；高鹏联盛减少 24.0525 万元注册资本；腾元投资减少 10.933 万元注册资本；易荣坤减少 16.3994 万元注册资本；上海芯璵减少 70.0829 万元注册资本。

2026 年 3 月 4 日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次减资完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	高鹏翼盛	750.6548	15.0048

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
2	高鹏联盛	211.7234	4.2321
3	易坤	664.4866	13.2824
4	晶格共智	600.0000	11.9934
5	YAXU	514.7212	10.2887
6	芯联启辰	404.6920	8.0894
7	上海芯琰	23.3610	0.4670
8	曾鸣	400.0000	7.9956
9	晶格共创	225.0000	4.4975
10	晶格共赢	215.0000	4.2976
11	晶格顶峰	210.0000	4.1977
12	晶格未来	200.0000	3.9978
13	华天集团	185.1871	3.7017
14	天利投资	7.2886	0.1457
15	陈艺琴	138.8903	2.7763
16	腾元投资	96.2381	1.9237
17	曾浩	50.0500	1.0004
18	融芯科技	50.0000	0.9994
19	凌风	50.0000	0.9994
20	易荣坤	5.4665	0.1093
合计		5,002.7596	100.0000

(13) 第六次股权转让

2026年3月4日,晶艺半导体召开股东会,全体股东一致同意如下股权转让事项,其他股东一致同意放弃优先购买权。本次股权转让的具体情况如下:

转让方	受让方	出资额(万元)	股权比例(%)	转让对价(万元)
高鹏翼盛	晶艺求精	140.8023	2.8145	1,064.465300
	李六军	144.4444	2.8873	1,091.999700
高鹏联盛	晶艺求精	51.6232	1.0319	390.271400
	李六军	28.8311	0.5763	217.963100
腾元投资	晶艺共治	36.5702	0.7310	276.470712
	晶艺共治	39.8344	0.7962	301.148064
	易坤	20.0000	0.3998	151.200000
芯联启辰	薛峰	40.0000	0.7996	302.400000
	陈国栋	40.0000	0.7996	302.400000
	苏鹏飞	20.0000	0.3998	151.200000
华天集团	晶艺共治	67.1530	1.3423	507.676680
	晶艺求精	5.9872	0.1197	45.263232
陈艺琴	晶艺共治	54.8551	1.0965	414.704556

2026年3月10日,上述股权转让双方签署了《关于晶艺半导体之股权转让协议》。

2026年3月19日,晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记,并取得成都高新技术产业开发区市场监督管理局核发的新的《营业执照》。

本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	易坤	684.4866	13.6822
2	晶格共智	600.0000	11.9934
3	晶格共创	225.0000	4.4975
4	晶格共赢	215.0000	4.2976
5	晶格顶峰	210.0000	4.1977
6	晶格未来	200.0000	3.9978
7	YAXU	514.7212	10.2888
8	曾鸣	400.0000	7.9956
9	晶艺求精	198.4127	3.9661
10	晶艺共治	198.4127	3.9661
11	高鹏翼盛	465.4081	9.3030
12	高鹏联盛	131.2691	2.6239
13	腾元投资	59.6679	1.1927
14	芯联启辰	244.8576	4.8945
15	上海芯璵	23.3610	0.4670
16	华天集团	112.0469	2.2397
17	天利投资	7.2886	0.1457
18	李六军	173.2755	3.4636
19	融芯科技	50.0000	0.9994
20	曾浩	50.0500	1.0004
21	凌风	50.0000	0.9994
22	薛峰	40.0000	0.7996
23	陈国栋	40.0000	0.7996
24	苏鹏飞	20.0000	0.3998
25	陈艺琴	84.0352	1.6798
26	易荣坤	5.4665	0.1093
合计		5,002.7596	100.0000

（14）第七次股权转让

2026年3月18日，晶艺半导体召开股东会，全体股东一致同意：原股东上海芯璵将其所持公司注册资本23.3610万元（占比0.4670%）转让给芯联启辰，原股东曾鸣将其所持公司注册资本200万元（占比3.9978%）以0元的价格转让给曾岳琦。上海芯璵、曾鸣分别与芯联启辰、曾岳琦签署了《股权转让协议》。2026年3月24日，晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次股权转让完成后，晶艺半导体的股东及其持股情况如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	易坤	684.4866	13.6822
2	YAXU	514.7212	10.2888
3	曾鸣	200.0000	3.9978
4	曾岳琦	200.0000	3.9978

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
5	晶格共智	600.0000	11.9934
6	晶格共创	225.0000	4.4975
7	晶格共赢	215.0000	4.2976
8	晶格顶峰	210.0000	4.1977
9	晶格未来	200.0000	3.9978
10	晶艺求精	198.4127	3.9661
11	晶艺共治	198.4127	3.9661
12	李六军	173.2755	3.4636
13	融芯科技	50.0000	0.9994
14	曾浩	50.0500	1.0004
15	凌风	50.0000	0.9994
16	薛峰	40.0000	0.7995
17	陈国栋	40.0000	0.7995
18	苏鹏飞	20.0000	0.3998
19	高鹏翼盛	465.4081	9.3030
20	高鹏联盛	131.2691	2.6239
21	腾元投资	59.6679	1.1927
22	陈艺琴	84.0352	1.6798
23	易荣坤	5.4665	0.1093
24	芯联启辰	268.2186	5.3615
25	华天集团	112.0469	2.2397
26	天利投资	7.2886	0.1457
合计		5,002.7596	100.0000

3. 企业经营概况

(1) 主要产品及用途

1) 主营业务情况

标的公司是国内领先的电机驱动功率模块和电源管理模拟芯片等产品的研发、设计和销售企业，主要产品包括 IPM 模块、DC-DC 芯片等。标的公司产品广泛应用于家电、高端消费电子、智能电表、光模块、固态硬盘(SSD)、安防等市场领域，得到下游客户普遍认可，客户结构优质且多元。同时，标的公司利用电源管理芯片技术研发的积累和生产封装跟踪管理、监控等方面的经验，向客户提供芯片定制化量产服务业务，产品主要应用于服务器、通信等领域。

标的公司持续加大 DC-DC 芯片产品研发投入，丰富产品矩阵，在中低压 DC-DC 芯片及部分中高端应用中形成较强竞争力，根据弗若斯特沙利文测算数据，2025 年，标的公司跻身国内 DC-DC 市场本土厂商出货量前五。其中，智能电表领域，标的公司超低纹波、高抗干扰、高效率降压的 DC-DC 芯片市占率位居行业前列，应用于国家电网、南方电网等核心终端客户；安防领域，标的公司为客户提供外围器件极简、成本最优化的解决方案，已

成功导入海康威视、大华股份等安防行业龙头企业；光模块领域，公司为少数可实现多品类芯片量产、提供较为全面电源管理解决方案的国产芯片供应商，已成功导入华工科技、光迅科技、联特科技等头部客户。

标的公司围绕空调风机用半桥 IPM 持续布局，在白色家电半桥 IPM 领域最早实现产品导入及规模化出货，并与下游客户建立了相对稳定的合作关系。标的公司半桥 IPM 模块在白色家电等终端场景细分领域已占据较高市场份额。根据弗若斯特沙利文测算数据，2025 年标的公司产品在国内 IPM 半桥模块市场份额达 53.5%。

2) 主要产品及用途

① 自研业务

标的公司专注于电机驱动模块和电源管理芯片领域，主要产品包含半桥/全桥 IPM、DC-DC 芯片、AC-DC 芯片多个系列产品，其中 IPM 模块、DC-DC 芯片是公司主要的产品系列。

类别	产品系列	主要功能	产品类型	应用领域
电机驱动	IPM 模块	集成功率开关器件、驱动电路、保护电路和控制电路于一体，实现对高功率负载的高效、安全、智能化控制	半桥/全桥 IPM	主要适用于变频家电、风机驱动等
	驱动 IC	过压保护、欠压保护、直通防止及死区保护等功能	微机驱动 IC 芯片	适用于电机驱动的各类应用领域场景，可以与电机主控芯片、功率器件共同构成电机驱动控制系统
电源管理模拟芯片	DC-DC 芯片	实现直流电源的升压或降压	Buck 降压型芯片	家电、网络通信、安防监控、智能电表、服务器、通信、光模块、固态存储、高端消费电子等
			Boost 升压型芯片	
			Buck-Boost 升降压型芯片	
	其他产品	-	包括 AC-DC 芯片、POL、PMIC、Road-Switch 等产品	

A. 电机驱动类产品

a. 智能功率模块（IPM）

智能功率模块（Intelligent Power Module，IPM）是将功率器件（如 IGBT 或 MOSFET）与驱动电路、保护电路等功能集成于一体的电力电子模块。相比传统分立器件方案，IPM 通过高度集成化设计，在实现对功率器件的驱动与控制功能的同时，集成过流、过压、过热等多重保护能力，从而提升系统的安全性、可靠性及运行效率。随着电力电子系统向高功率密度、小型化及高可靠性方向发展，IPM 逐步由传统分立器件替代方案，演进为电机驱动及功率控制系统中的关键组件，在提升电机驱动性能、提高系统效率方面发挥关键作用，系变频家电不可或缺的关键组件之一，广泛应用于变频空调、冰箱、洗衣机等白色家电行业以及工业变频器、伺服器、车用空调等领域。

在结构形式上，IPM 方案逐渐从传统的三相全桥集成模块，向更加灵活的半桥模块组合方案演进。其中，三相全桥 IPM 以高集成度和成熟度为特点，广泛应用于中高功率场景；而以三颗半桥 IPM 构成三相系统的方案，则在布局灵活性、散热性能及生产工艺等方面展现出优势，逐步在家电及中低功率应用中得到推广。标的公司主要深耕 IPM 领域的半桥模块技术路线，凭借自主研发的特色封装技术、高可靠性高压半桥驱动 IC（HVIC）设计技术等核心技术，采用半桥技术路线开发的产品可高效适配变频家电电机驱动的应用场景；此外，标的公司兼顾开发三相全桥 IPM 产品，储备全桥 IPM 产品相关研发技术，实现智能功率模块全产品路线的布局。

相较于三相全桥 IPM 方案，三颗半桥 IPM 构成三相系统的方案采用模块化设计思路，即每颗 IPM 负责一个桥臂，通过三颗独立模块组合实现完整的三相驱动功能。该方案在结构上将原本集中于单一模块的功率器件进行物理分散，使系统在布局上具备更高灵活性，特别适用于空间结构复杂或对布线对称性要求较高的应用场景。

从技术角度来看，半桥 IPM 方案在多个方面展现出优势。在布局方面，半桥 IPM 模块可根据系统结构进行分散布置，有助于缩短功率回路路径并降低寄生参数；在热管理方面，热源分布更加均匀，可有效降低局部热点，提高整体散热效率，相比全桥 IPM 方案无需单独配置散热器件，节省客户方案成本；由于每个桥臂独立运行，系统能够实现更精细的温度监测与保护，提高运行安全性。此外，半桥 IPM 产品通常采用标准化封装，适用于自动化贴片工艺，在大批量生产中具备较好的制造效率及成本优势。另一方面，由于半桥 IPM 产品在行业应用时间较短，技术优化仍在验证迭代过程中，目前半桥 IPM 方案在高功率场景适配性、规模化应用成熟度等方面相比全桥 IPM 方案存在劣势。不同技术路线 IPM 产品实现效果具体对比情况如下：

	具体维度侧重	不同路线实现效果	
		三相全桥 IPM 路线	半桥 IPM 路线
系统集成度	功率器件及驱动电路在单一模块中的集成水平	强	较强
结构布局灵活性	模块在 PCB 及系统中的布局自由度及对不同电机结构（如环形/分布式结构）的适配能力	弱	强
热管理与温度控制能力	热量分布均匀性及温度监测与保护的精细化程度	弱	强
制造工艺适配性	模块对自动化生产及贴片工艺的适配程度及量产效率	弱	较强
成本结构与应用匹配度	在不同功率场景下的综合成本表现及适配能力	中等	强
高功率适配能力	在高功率及大电流场景下的适用能力及系统实现复杂度	强	弱

资料来源：公开资料，弗若斯特沙利文

b.驱动 IC 产品

功率驱动芯片（HVIC）是用于控制和驱动功率器件（MOSFET、IGBT 或 SiC MOSFET）的专用集成电路，通过提供栅极驱动信号、电压及电流控制以及多种保护功能，实现对电能

转换与执行单元的精准控制。该类芯片通常不直接参与电压转换过程，而是连接控制系统与功率器件，在电力电子系统中承担关键的驱动与控制功能。

标的公司拥有自主设计研发驱动 IC 产品的能力，主要 HVIC 产品技术应用于智能功率模块（IPM）产品的集成驱动，少量产品作为 BLDC 电机驱动芯片或门驱动集成电路（Gate Driver IC）对外独立进行销售。

B.电源管理模拟芯片

DC-DC 芯片主要作用是将外部直流输入电压，转换成数字芯片、电子产品执行装置中适用的工作电压，并实现稳定供电，保障电子产品的平稳运行。DC-DC 芯片产品应用领域广泛，覆盖计算、通信电子、存储、工业应用、消费电子等众多应用场景，具体细分市场包括通信、服务器、安防、智能电表、光模块、固态硬盘等。

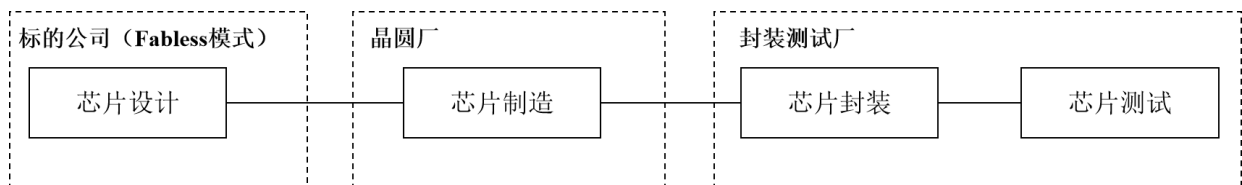
标的公司根据不同电压等级转换需求，基于与所需转换电压相匹配的自有工艺，针对性进行电路设计，DC/DC 芯片涵盖了 Buck 降压型芯片、Boost 升压型芯片和升降压转换器产品；同时标的公司结合下游终端设备的系统应用特点进行优化，并基于自有 DC-DC 控制技术，实现产品的高效率、高可靠性和良好电源特性。

② 芯片定制化量产业务

标的公司芯片定制服务主要为利用电源管理芯片技术研发的积累和生产封装跟踪管理、监控等方面的经验，为客户提供芯片定制服务业务，产品主要应用于服务器、通信等领域。标的公司协助客户开发芯片测试程序、委托封装测试厂对芯片裸片进行封装测试，及时跟踪芯片封装良率，进行反馈沟通，最终向客户交付经过封装测试的合格芯片，并提供产品的应用技术支持。

（2）主要产品的工艺流程图或主要服务的流程图

标的公司采用集成电路行业典型的 Fabless 模式，即无晶圆生产线集成电路设计模式，标的公司专注于集成电路的研发设计和销售，而将晶圆制造、封装测试等生产环节外包给晶圆厂、封测厂完成。标的公司总体业务流程图如下：



（3）主要经营模式

1) 盈利模式

报告期内，标的公司采用 Fabless 经营模式，专注于产品的研发设计与市场销售环节。标的公司的收入主要来源于电机驱动产品和电源管理芯片的销售。

2) 采购及生产模式

标的公司采用 Fabless 经营模式，主要负责芯片的设计、工艺调试及产品质量管控，将晶圆制造、封装测试等生产环节委托给专业的晶圆代工、封测厂商完成。具体而言，标的公司完成集成电路版图设计后，委托晶圆厂商开展晶圆生产；晶圆成品交付后，再交由合作封装测试厂商完成产品的封装、测试工序，最终形成合格成品。标的公司的晶圆代工厂和封装测试服务供应商多为行业知名企业。

3) 销售模式

与模拟芯片设计行业的其他公司相似，标的公司采用“经销为主、直销为辅”的销售模式，标的公司向直销客户与经销客户销售均属于买断式销售，即在标的公司将产品销售给经销商客户或直销客户后，商品的所有权转移至下游客户。

① 经销模式

标的公司经销商客户主要为芯片分销商或贸易商。经销模式下，经销商结合市场情况及终端客户需求将订单下达至标的公司，后续的出货、对账、开票、结算等事项标的公司均与经销商沟通，部分大型终端客户的技术服务工作由标的公司应用工程师（FAE）对接。

标的公司已建立了《经销商渠道操作制度》《经销商配合度考核标准》《订单操作规则》等经销商开发及管理制度，对经销商的导入、日常管理进行规范化运作。标的公司在选择经销商时主要考虑其资金实力、市场销售网络、技术服务能力、合作稳定性、商业信用等因素。

② 直销模式

直销模式下，标的公司直接接收终端客户订单并完成产品交付，并直接为其提供相应的技术支持。报告期内，标的公司直销模式合作客户情况较少。

4) 研发模式

在 Fabless 经营模式下，产品设计及研发是标的公司经营的核心。标的公司具体研发流程包括立项、设计、验证、风险量产四个阶段，并由芯片开发部、工程与生产经营部、产品与市场事业部、技术支持与销售部的各职能部门合作完成。

① 立项阶段

标的公司管理层及产品与市场事业部初步提出新产品的开发需求，联合芯片开发部、工程与生产经营部代表对产品可行性进行研究，组织立项会议，共同参与风险分析及评审决策，对项目基本需求、目标应用市场、市场竞争力、项目可行性、项目成本等方面进行综合评判，评审通过后项目正式立项。

② 研发设计阶段

标的公司芯片开发部门主要包括芯片设计部、版图设计部、器件与工艺开发部、封装设计部等四条业务线。项目立项后，产品与市场事业部相关人员根据需求撰写工程研发文档，详细规划出产品规格定义和性能指标，芯片设计部成员根据产品定义规划、拆分设计

方案、完成电路原理设计、设计验证与仿真，并交由版图设计部。如相关产品涉及器件开发集成及先进封装工艺设计，相应器件与工艺开发部、封装设计部成员同步参与上述产品开发过程。

③ 工程送样阶段

设计阶段完成后，工程与生产经营部团队将向晶圆厂和封测厂下达工程样品生产和封测的指令。工程样品生产完成后，测试部及产品与市场事业部的应用工程师对该产品进行各场景功能、性能测试验证和可靠性验证。样品通过所有验证环节并经过各部门评审后，可进入风险量产阶段。

④ 风险量产阶段

工程送样阶段，产品工程团队将安排产品的风险量产，并由产品工程、测试工程团队在收集分析测试数据以优化测试方法，形成量产管控的具体要求，以确保产品的可生产性。新产品通过风险量产评审后，将进入规模量产阶段。

5) 结算模式

标的公司按照客户的订单完成产品交付，开具发票完成后，按照双方所签订合同约定方式收取相应货款，客户一般采用银行转账的方式支付货款。

(4) 核心技术及核心技术人员情况

1) 主要核心技术情况

标的公司的核心技术情况具体如下表所示：

序号	主要核心技术	技术先进性和具体表征	应用领域	是否取得专利或其他技术保护措施	技术所处的生产阶段
1	单相半桥 IPM 模块封装技术和器件开发	1、满足高集成度要求的前提下，研发了一系列单相半桥 IPM 产品，集成驱动芯片和开关芯片； 2、提供业内领先的贴片封装类型，通过机贴模式有效降低贴片成本和工艺难度，兼顾优异的散热性能； 3、持续改善封装工艺，实现导电性再布线层的平整化，提高晶粒表面焊线密度；新一代产品封装进一步优化散热性能，增加外露基岛、电气间隙和爬电距离； 4、为 IPM 模块开发 IGBT 器件，自行开发 SiC-MOS 器件，集成第三代半导体 SiC-MOS； 5、设计的驱动电路可克服电机在转动时受反电动势的影响而导致的电机转速与 MCU 输出的 PWM 信号成非线性关系； 6、新一代产品进行隔离驱动设计，针对驱动电路中供电电路进行特别设计，保证驱动电路内	电机驱动	是 已经取得专利： 1.ZL2019211896995 2.ZL2024212464665 3.ZL2023236697747 4.ZL2024232063893	大批量产，部分最新产品还处于研发阶段

序号	主要核心技术	技术先进性和具体表征	应用领域	是否取得专利或其他技术保护措施	技术所处的生产阶段
		部电源快速建立以及及时给系统内部提供供电电压并快速建立相关控制环路			
2	电机驱动中的控制技术	1、硬件化微步细分，有效降低对 MCU 算力的依赖，使得低成本的 MCU 也能驱动高精度的步进电机； 2、采用固定占空比实现微步驱动控制，不需要额外调整占空比，电机在低速运行时电流波形平滑，消除了因 MCU 算力时延导致的低频振荡和噪音，实现更高的定位精度和抗干扰能力，提升系统运行的平稳性； 3、纯硬件电路实现超前角控制，摆脱 MCU 依赖，兼顾精度与灵活性，保证换相逻辑的准确性和稳定性； 4、通过电流波形重构的控制方法，实现全周期的电流精确跟随，显著降低了转矩脉动，实现较高的转速精度； 5、提出电机软换相控制方案，实现电机在不同驱动速度下的性能调节，提高电机的转速控制精度，降低了噪音	电机驱动	是 已经取得专利： 1.ZL2023108486939 2.ZL2024101996846 3.ZL2023115971996 4.ZL2023109064366	大批量产
3	AC/DC 电压转换器的控制和封装技术	1、首款实现 1500V 全集成 flyback 解决方案，在强磁环境下扩大了安全工作区，提高系统的带载能力和过载保护可靠性； 2.提出新的功率因数校正方案，有效提高功率因数，降低了总谐波畸变值； 3、提出多种高压 BUCK 控制方案，提高系统在轻载或空载条件下的瞬态响应速度和效率； 4.提出简单高效的准谐振控制方案，可实现在不同参数条件下的高效控制； 5、开发转换器中的 MOS 器件，新一代产品集成第三代半导体 SiC-MOS，保障产品优秀的功率密度和高应用可靠性	电源管理	是 已经取得专利： 1.ZL2024106701140 2.ZL2021115720043 3.ZL202222959189X 4.ZL2022231117007 5.ZL2022106194109 6.ZL2023103181239 7.ZL2022108736569	大批量产
4	电压转换器中可靠性和稳定性设计	1、提出多种针对提升芯片可靠性的设计，如稳定供电电压、过欠压保护、短路检测、过流保护、ESD 保护等； 2、针对开关变换器稳定性，提出多种设计方案	电源管理	是 已经取得专利： 1.ZL2019108991749 2.ZL2022115352972 3.ZL2023114231373 4.ZL2023118492029 5.ZL2023101072966 6.ZL2023104094454 7.ZL2023100266659 8.ZL2024226045652	大批量产

序号	主要核心技术	技术先进性和具体表征	应用领域	是否取得专利或其他技术保护措施	技术所处的生产阶段
5	电压转换器中的驱动技术	1、设计多种自举电路，避免自举电容充电后电压不足的问题； 2、提供多种减小开关公共节点正负压过冲和开关应力的设计方案，有效提高了芯片的稳定性和可靠性； 3、提出多种电平转换电路，避免因干扰出现误触发，保证其输出端的电位始终处于正确状态不受功率转换点的变化影响； 4、创新实现 nF 级别自举电容设计，减少了驱动电路对芯片面积占用； 5、提出多种电流采样方法，实现对电感电流任一时段的快速电流采样；同时设计采样保持电路，延长了采样保持时间	电源管理	是 已经取得专利： 1.ZL2024208705781 2.ZL2023102251234 3.ZL2022116984147 4.ZL2024100041556 5.ZL2023114160861 6.ZL2022235949905 7.ZL2023114160861 8.ZL2022103066397 9.ZL2022108715670	大批量产，部分最新产品还处于研发阶段
6	降压转换器的控制技术	1、弥补高压超低功耗 DC/DC 的市场空缺，实现 23V 最高输入，450nA 的超低功耗； 2、通过关断时间补偿设计，实现较小的占空比，用于高频率下拓展开关变换器的稳定工作范围； 3、根据电流过流值的大小自适应调整主开关管的延时时长，达到限流的目的； 4、在 COT 控制中实现了开关变换器频率与外部时钟频率的同步，简化锁相环设计； 5、提出多种双环控制策略，有效提高了转换器的响应速度，且能够有效处理噪声干扰，提升整个转换器的稳定性； 6、设计准谷底电流控制，实现在异步解决方案中有效监控和控制续流电流，确保电流在谷底值范围内，避免电流过大对系统造成损坏； 7、设计多种异步合封器件中的过温保护方案，防止分离开关器件因发热而烧毁	电源管理	是 已经取得专利： 1.ZL2022115352972 2.ZL202210425274X 3.ZL2022102770782 4.ZL2023102564775 5.ZL202210692478X 6.ZL2024221559927 7.ZL2019108987599 8.ZL2020108314233 9.ZL2023113879514 10.ZL2023113879529	大批量产
7	升压转换器中的控制技术	1、设计 300nA 超低功耗的升压转换器，通过对开关变换器休眠状态的准确判断，消除失调电压的影响，可准确判断开关变换器进入休眠或退出休眠的时机，提高功耗控制的准确性，实现超低功耗； 2、提出升压转换器中电流过零检测技术，有效提高电流过零检测的准确性，避免 Boost 电路输出端的电流返流，增强系统的控制精度和效率； 3、提出新的升降压转换器控制方法，提高	电源管理	是 已经取得专利： 1.ZL2024104969164 2.ZL202311642414X 3.ZL2022104734422	大批量产，部分最新产品还处于研发阶段

序号	主要核心技术	技术先进性和具体表征	应用领域	是否取得专利或其他技术保护措施	技术所处的生产阶段
		BUCK-BOOST 开关变换器在不同模式下的效率和稳定性			
8	多相电压转换器的控制技术	1、实现了每个电压转换器的独立工作和均流控制，提高了电压转换器的动态响应速度，确保了输出电流的均匀性和系统的稳定性； 2、在多相电压转换器中，补偿电路采用下降斜率随电压变换电路的相数值和电感电流采样信号的值变化而变化的斜坡信号，以对控制环路进行斜坡补偿，有效提高多相电压转换器的稳定性； 3、采用创新设计结构将多个电压转换器设置为主从配置系统，可根据具体应用的需要调节变换器级联系统的总相数； 4、设计专有的多相电路适用的芯片封装结构和 PCB 线路板布线结构，降低多相电路之间连接设计的复杂度，节约 PCB 线路板空间，利于电路集成化和产品小型化	电源管理	是 已经取得专利： 1.ZL2022110603090 2.ZL202210141818X 3.ZL2021114347370 4.ZL2024225136391	基础研发为主，部分产品大批量产
9	POE 模块通信供电	1、提出双闭环平滑切换机制，将 POE 握手逻辑从开环状态响应提升为闭环主动控制，解决握手信号抖动，避免传统方案在 PSE 电压下降瞬间导致的误判； 2、适合应用于对连接可靠性要求极高的工业以太网交换机、恶劣环境下的 POE 受电设备，以及要求通过严格兼容性测试的 POE 电源管理芯片设计	电源管理	是 已经取得专利： 1.ZL2023117378312	大批量产
10	负载开关以及低压差线性调节器 (LDO) 控制技术	1、针对负载开关提供适配的驱动方案，可在不同负载条件下维持稳定的自举电压，降低功耗，提高可靠性； 2、提出多种负载开关和低压差线性调节器设计方案，具有较好的动态响应速度和输出电压稳定性	电源管理	是 已经取得专利： 1.ZL2021105863197 2.ZL2022115974044 3.ZL2024118732474 4.ZL2023105846487	大批量产
11	芯片测试硬件开发	1、开发多种测试硬件，简化控制程序设计，降低测试开发复杂度，同时实现高精度、高可靠性测试； 2、节约测试机资源，降低设备采购成本，支持更大规模的并行测试，提升测试产能； 3、形成从实验室特性分析到量产测试的完整测试技术体系，为芯片产品的质量保障和交付能力提供技术支撑 4、基于汽车电子标准指导，自行开发多种测试算法，对芯片测试参数分析、处理，将正态分	芯片测试技术，同时应用于自研及定制化量产业务	是 已经取得专利： 1.ZL2024230978332 2.ZL2023216839891 3.ZL2023104871852	大批量产

序号	主要核心技术	技术先进性和具体表征	应用领域	是否取得专利或其他技术保护措施	技术所处的生产阶段
		布以外的芯片剔除,提升产品品质; 5、持续迭代更新算法,保证产品质量进一步提升			

2) 核心技术人员情况

报告期内,标的公司的核心技术人员为易坤、唐锐、杨斯龙、包涵、周泉。

核心技术人员	工作经历	对标公司研发的具体贡献
易坤	硕士学历,25年以上功率半导体研发、产品线组建经验,曾为全球电源管理IC龙头MPS中国区核心成员。2019年成立标的公司,担任标的公司总经理	在标的公司成立起,负责建设芯片设计团队,带领研发团队相继攻关电源管理、电机驱动芯片产品,为标的公司芯片发展奠定基础,拥有多项国内、国际专利
唐锐	本科学历,曾在MPS、英特格灵芯片有限公司担任主任测试工程师。2019年加入标的公司,担任标的公司测试总监	搭建标的公司测试平台,组建相关测试团队,制定开发流程,实现标的公司集成电路测试标准化、规范化
杨斯龙	本科学历,曾在MPS、内江新城建设指挥部办公室、深圳宝砾微电子有限公司任职,2019年加入标的公司,担任高级版图设计经理	负责模拟IC全新项目、改版、衍生品的版图设计;模拟IC版图的架构设计;部门对接,晶圆厂工艺对接;主持版图设计部的日常工作
包涵	硕士学历,曾在MPS、成都易冲半导体有限公司任职,2020年加入标的公司,担任产品线总监	负责标的公司IPM模块和微电机驱动产品线包括产品开发、客户技术支持等事务管理工作
周泉	博士学历,曾在电子科技大学、航天科工二院二十三所任职,2022年加入标的公司,担任IC设计工程师、高级经理	负责标的公司各类buck电源芯片、efuse芯片研发。根据不同应用需求,设计有时钟同步、多相并联、超低待机功耗等不同功能的电源芯片;设计有反向阻断、反接保护、高精度电流监测、多相并联、超低待机功耗等不同功能的efuse芯片。负责研发人才招聘,完善研发人才梯队

上述核心技术人员均与标的公司签署了保密协议,并参与了标的公司的股权激励。

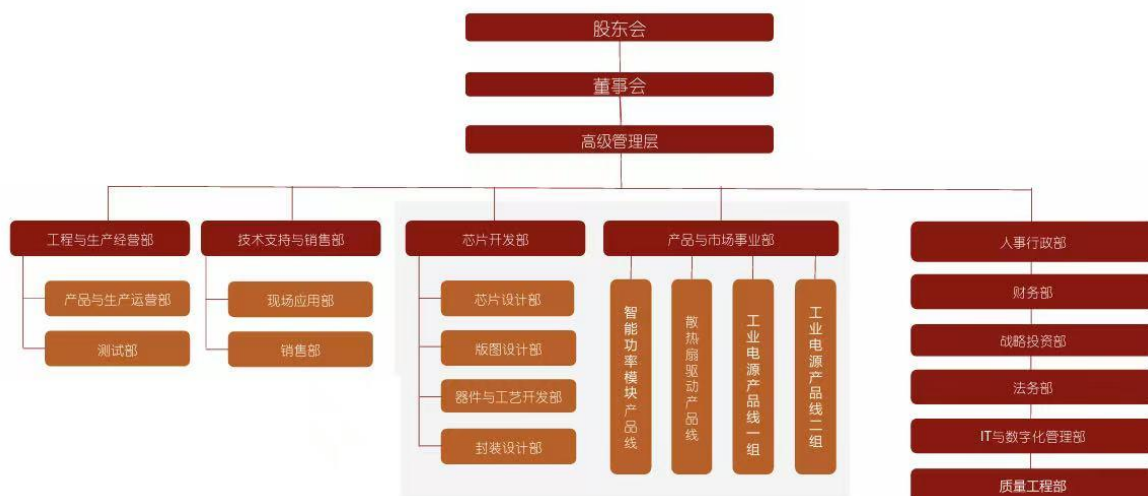
(5) 主要产品和服务的质量控制情况

标的公司制定完善的质量控制体系,取得了ISO9001、ISO14001质量体系认证,将产品质量控制贯穿设计开发、生产制造、客户服务完整链条。

报告期内,标的公司始终高度重视客户对产品和服务的质量反馈信息,积极通过设计开发过程、测试开发过程、可靠性验证过程、生产订单管理过程、代工厂管理过程、不合格品管理过程、客户投诉管理过程、客户满意度管理过程等体系化的管理控制,预防式地提前消除质量隐患。报告期内,标的公司及其子公司未发生过重大质量纠纷的情况。

4. 经营管理结构

企业的组织结构图如下：



企业拥有的各级控股企业概况如下：

企业名称	成立时间	注册资本	持股比例	
			直接	间接
香港晶艺半导体有限公司	2019年12月	100万元港币	100%	

5. 近年资产、财务、经营状况

企业两年一期（合并报表）的财务状况和经营成果概况如下：

金额单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日	2026年2月28日
资产总计	63,023.95	78,300.03	56,455.75
负债合计	9,428.36	39,992.73	15,638.18
所有者权益合计	53,595.59	38,307.30	40,817.57
归属于母公司所有者权益合计	53,595.59	38,307.30	40,817.57

项目	2024年	2025年	2026年1-2月
营业收入	25,493.82	34,971.68	8,106.74
利润总额	4,829.34	-1,498.11	-6,951.41
净利润	4,925.79	-1,984.29	-7,285.27
归属于母公司所有者的净利润	4,925.79	-1,984.29	-7,285.27

企业两年一期（母公司报表）的财务状况和经营成果概况如下：

金额单位：万元

项目	2024年12月31日	2025年12月31日	2026年2月28日
资产总计	57,916.21	73,343.04	51,926.96
负债合计	9,184.82	39,907.74	15,875.39

项目	2024年12月31日	2025年12月31日	2026年2月28日
所有者权益合计	48,731.40	33,435.30	36,051.57

项目	2024年	2025年	2026年1-2月
营业收入	24,668.97	34,894.00	8,106.74
利润总额	4,370.24	-1,665.28	-6,924.39
净利润	4,444.86	-2,102.70	-7,254.12

被评估单位两年一期的财务报表均已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见审计报告。

6. 委托人和被评估单位之间的关系

委托人为本次股权交易的收购方。

（三）资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人

资产评估委托合同约定无其他资产评估报告使用人。

除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

二、评估目的

根据《苏州锴威特半导体股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》，苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买晶艺半导体有限公司 100% 股权，为此需要对晶艺半导体有限公司的股东全部权益价值进行评估，为上述经济行为提供价值参考依据。

三、评估对象和评估范围

（一）评估对象和评估范围概况

本次评估对象为晶艺半导体有限公司的股东全部权益价值。

本次评估范围为晶艺半导体有限公司的全部资产和负债，包括流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产及负债。母公司报表总资产账面价值 519,269,595.07 元，总负债账面价值 158,753,879.76 元，所有者权益账面价值 360,515,715.31 元。合并总资产账面价值 564,557,548.00 元，合并总负债账面价值 156,381,832.39 元，合并所有者权益账面价值 408,175,715.61 元，归属于母公司所有者权益账面价值 408,175,715.61 元。

(二) 评估范围内主要资产概况

本次评估范围中的主要资产包括流动资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、长期待摊费用、递延所得税资产、其他非流动资产。

流动资产主要包括货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产。

长期股权投资为企业直接控股的子公司 1 家。

固定资产-设备包括固定资产-机器设备、固定资产-电子设备，共计 615 台（套/辆），账面原值 24,876,088.64 元，账面价值 10,681,019.79 元，均处于正常使用状态。

在建工程包括设备安装工程，账面价值 12,918.59 元。设备安装工程共 2 项，主要为购入暂未安装的格力柜机空调。

使用权资产为企业租赁的 7 处房屋。

无形资产-其他无形资产共计 12 项，包括外购软件 8 项、核心技术资产组 1 项（包含已授权专利 62 项、集成电路布图设计专有权 137 项）、商标资产组 1 项（包含商标权 2 项）、域名资产组 1 项（包含域名 2 项）、合同权益 1 项，其中核心技术资产组、商标资产组、域名资产组、合同权益 1 项在账面未反映。企业拥有的专利权、商标权、集成电路布图设计专有权和域名清单如下：

专利权清单

序号	发明名称	专利类型	法律状态	申请号	申请日	权利人
1	电压转换集成电路、高压 BUCK 变换器及控制方法	发明	专利权维持	201910140949.40	2019-02-26	晶艺半导体
2	主动式假性负载、开关电源变换器及控制方法	发明	专利权维持	201910447677.20	2019-05-27	晶艺半导体
3	准谐振控制电路及其谷底开通方法	发明	专利权维持	201910795474.20	2019-08-27	晶艺半导体
4	用于高压 BUCK 开关变换器的控制电路及方法	发明	专利权维持	201910886049.40	2019-09-19	晶艺半导体
5	无刷电机电流调节器、电机系统和控制方法	发明	专利权维持	201910898755.00	2019-09-23	晶艺半导体
6	短路检测电路及检测方法	发明	专利权维持	201910899174.90	2019-09-23	晶艺半导体
7	关断时间补偿电路、补偿方法及开关变换器	发明	专利权维持	201910898759.90	2019-09-23	晶艺半导体
8	一种准谷底控制电路和方法及其开关变换器	发明	专利权维持	202010831423.30	2020-08-18	晶艺半导体
9	一种高电源抑制比负载开关电路及其控制方法	发明	专利权维持	202110586319.70	2021-05-27	晶艺半导体
10	多相开关变换器级联系统及其电压变换电路	发明	专利权维持	202111434737.00	2021-11-29	晶艺半导体
11	用于功率因数校正的控制方法和电路	发明	专利权维持	202111572004.30	2021-12-21	晶艺半导体
12	具有斜坡补偿的控制电路及方法	发明	专利权维持	202210141818.X	2022-02-16	晶艺半导体
13	COT 控制电路和方法	发明	专利权维持	202210277078.20	2022-03-21	晶艺半导体
14	采样保持刷新电路、方法及电子装置	发明	专利权维持	202210306639.70	2022-03-25	晶艺半导体
15	COT 控制电路、方法以及相关集成电路	发明	专利权维持	202210425274.X	2022-04-21	晶艺半导体
16	BUCK-BOOST 的控制电路、方法及变换器	发明	专利权维持	202210473442.20	2022-04-29	晶艺半导体
17	基于 FLYBACK 的功率因数校正电路的控制电路和方法	发明	专利权维持	202210619410.90	2022-06-01	晶艺半导体
18	双电压定频控制电路、变换器及方法	发明	专利权维持	202210692478.X	2022-06-17	晶艺半导体
19	LED 调光系统及其控制电路和方法	发明	专利权维持	202210873656.90	2022-07-21	晶艺半导体

序号	发明名称	专利类型	法律状态	申请号	申请日	权利人
20	一种乘法器电路	发明	专利权维持	202210871567.00	2022-07-22	晶艺半导体
21	开关集成电路、开关电源系统以及控制方法	发明	专利权维持	202211060309.00	2022-08-31	晶艺半导体
22	电源系统的控制电路、供电电压产生电路及刷新方法	发明	专利权维持	202211535297.20	2022-11-30	晶艺半导体
23	负载开关电路及其控制电路和自举电压产生方法	发明	专利权维持	202211597404.40	2022-12-12	晶艺半导体
24	开关变换器的驱动控制电路及驱动方法	发明	专利权维持	202211698414.70	2022-12-28	晶艺半导体
25	斜坡补偿电路及相关控制电路和方法	发明	专利权维持	202310026665.90	2023-01-09	晶艺半导体
26	一种温度检测模块和过温保护电路	发明	专利权维持	202310107296.60	2023-02-14	晶艺半导体
27	电压电流双环控制电路、方法以及开关变换器	发明	专利权维持	202310256477.50	2023-03-16	晶艺半导体
28	用于开关变换器的控制电路、系统及方法	发明	专利权维持	202310409445.40	2023-04-18	晶艺半导体
29	半导体合封器件及其过温保护电路和方法	发明	专利权维持	202311387952.90	2023-10-25	晶艺半导体
30	用于合封器件的过温保护电路、方法及半导体器件	发明	专利权维持	202311387951.40	2023-10-25	晶艺半导体
31	应用于功率开关的驱动电路及电源管理芯片	发明	专利权维持	202311416086.10	2023-10-30	晶艺半导体
32	带欠压保护的启动电路和控制电路	发明	专利权维持	202311423137.30	2023-10-31	晶艺半导体
33	直流无刷电机的启动电路、驱动装置及方法	发明	专利权维持	202311597199.60	2023-11-28	晶艺半导体
34	用于 Boost 电路的过零检测电路、启动电路及过零检测方法	发明	专利权维持	202311642414.X	2023-12-04	晶艺半导体
35	一种应用于 POE 系统的通信握手电路及方法	发明	专利权维持	202311737831.20	2023-12-18	晶艺半导体
36	钳位电路、模拟光耦电路及隔离驱动电路	发明	专利权维持	202311763395.60	2023-12-21	晶艺半导体
37	一种斜坡信号产生电路及产生方法	发明	专利权维持	202311849202.90	2023-12-29	晶艺半导体
38	驱动电路及其驱动方法、控制电路以及电源芯片	发明	专利权维持	202310225123.40	2023-03-10	晶艺半导体
39	电源系统的控制电路和控制方法	发明	专利权维持	202310318123.90	2023-03-29	晶艺半导体
40	高精度电流控制的负载开关电路及其修调方法	发明	专利权维持	202310584648.70	2023-05-23	晶艺半导体
41	芯片均压测试系统	发明	专利权维持	202310487185.20	2023-05-04	晶艺半导体
42	直流无刷电机折线调速控制电路和方法	发明	专利权维持	202310653474.50	2023-06-03	晶艺半导体
43	具有超前角的换相控制电路、电机系统及换相控制方法	发明	专利权维持	202310848693.90	2023-07-12	晶艺半导体
44	一种用于步进电机系统的微步驱动电路和方法	发明	专利权维持	202310906436.60	2023-07-24	晶艺半导体
45	用于电机驱动的软换相控制电路、方法及电机驱动系统	发明	专利权维持	202410199684.60	2024-02-23	晶艺半导体
46	电压比较电路、控制方法及 BOOST 开关变换器	发明	专利权维持	202410496916.40	2024-04-24	晶艺半导体
47	开关电源系统及其控制电路和方法	发明	专利权维持	202410670114.00	2024-05-28	晶艺半导体
48	一种电平转换电路及其抗干扰方法	发明	专利权维持	202410004155.60	2024-01-03	晶艺半导体
49	低压差线性稳压电路	发明	专利权维持	202411873247.40	2024-12-18	晶艺半导体
50	功率模块的封装框架, 封装框架阵列及封装体	实用新型	专利权维持	201921189699.50	2019-07-26	晶艺半导体
51	用于开关变换器的集成电路和 SOP 封装结构	实用新型	专利权维持	202222959189.X	2022-11-07	晶艺半导体
52	一种用于高压 BUCK 开关电源芯片的封装体	实用新型	专利权维持	202223111700.70	2022-11-17	晶艺半导体
53	一种电平转换电路	实用新型	专利权维持	202223594990.50	2022-12-30	晶艺半导体
54	一种用于芯片测试的继电器扩容电路	实用新型	专利权维持	202321683989.10	2023-06-30	晶艺半导体
55	芯片封装结构	实用新型	专利权维持	202323669774.70	2023-12-29	晶艺半导体
56	一种应用于开关变换器的自举电压充电电路	实用新型	专利权维持	202420870578.10	2024-04-24	晶艺半导体

序号	发明名称	专利类型	法律状态	申请号	申请日	权利人
57	封装结构及半导体器件	实用新型	专利权维持	202421246466.50	2024-06-03	晶艺半导体
58	多端口充电系统	实用新型	专利权维持	202422155992.70	2024-09-03	晶艺半导体
59	芯片封装结构和 PCB 线路板布线结构	实用新型	专利权维持	202422513639.10	2024-10-17	晶艺半导体
60	双向 ESD 保护电路	实用新型	专利权维持	202422604565.20	2024-10-28	晶艺半导体
61	一种芯片的等效阻抗测试电路	实用新型	专利权维持	202423097833.20	2024-12-16	晶艺半导体
62	RC-IGBT 半导体器件及其版图结构	实用新型	专利权维持	202423206389.30	2024-12-25	晶艺半导体

集成电路布图设计专有权清单

序号	布图设计名称	登记号	创作完成时间	权利人
1	LA65S71120	BS.245599703	2024-10-09	晶艺半导体
2	LA12S21112	BS.245600485	2024-06-13	晶艺半导体
3	LA28S31114	BS.245600728	2024-04-12	晶艺半导体
4	LA65S41120	BS.245599665	2024-10-09	晶艺半导体
5	LA61S51119	BS.245599525	2024-04-18	晶艺半导体
6	LA10C41115	BS.245600744	2024-04-07	晶艺半导体
7	LA23S11101	BS.245599339	2024-07-25	晶艺半导体
8	LA16S21113	BS.245600574	2024-05-13	晶艺半导体
9	LA20S21108	BS.245600310	2024-05-16	晶艺半导体
10	LA33M11111	BS.245600418	2024-08-20	晶艺半导体
11	LA16S11113	BS.245600558	2024-05-13	晶艺半导体
12	LA16S71120	BS.245600183	2024-05-13	晶艺半导体
13	LA12C31115	BS.245600752	2024-09-18	晶艺半导体
14	LA16S61120	BS.245599711	2024-05-13	晶艺半导体
15	LA31U21108	BS.24560040X	2024-09-30	晶艺半导体
16	LA00U21126	BS.245600817	2024-09-19	晶艺半导体
17	LA61S21119	BS.245599487	2024-04-18	晶艺半导体
18	LA65S31120	BS.245599649	2024-10-09	晶艺半导体
19	LA61S41119	BS.245599509	2024-04-18	晶艺半导体
20	LA16S31113	BS.245600582	2024-05-13	晶艺半导体
21	LA91C51125	BS.245600701	2024-10-24	晶艺半导体
22	LA63M11113	BS.24560068X	2024-02-27	晶艺半导体
23	LA23S31106	BS.245599452	2024-07-25	晶艺半导体
24	LA65S51120	BS.245599673	2024-10-09	晶艺半导体
25	LA23S21106	BS.245599444	2024-07-25	晶艺半导体
26	LA12S31113	BS.245600515	2024-06-13	晶艺半导体
27	LA26S61219	BS.24560345X	2023-12-18	晶艺半导体
28	LA12C31219	BS.245603468	2024-01-24	晶艺半导体
29	LA23S41106	BS.245599479	2024-07-25	晶艺半导体
30	LA25S11125	BS.245600647	2024-08-29	晶艺半导体
31	LA33S11112	BS.245600469	2024-08-19	晶艺半导体
32	LA33S41125	BS.245600396	2024-08-08	晶艺半导体

序号	布图设计名称	登记号	创作完成时间	权利人
33	LA25S21125	BS.245600663	2024-08-29	晶艺半导体
34	LA33S21122	BS.245600337	2024-08-08	晶艺半导体
35	LA33S31122	BS.245600361	2024-08-08	晶艺半导体
36	LA33S11120	BS.245600329	2024-08-08	晶艺半导体
37	LA63M21113	BS.245600698	2024-09-29	晶艺半导体
38	LA65S61120	BS.24559969X	2024-10-09	晶艺半导体
39	LA65S21120	BS.245599614	2024-10-09	晶艺半导体
40	LA61S31119	BS.245599495	2024-04-18	晶艺半导体
41	LA31U21125	BS.245600620	2024-04-19	晶艺半导体
42	LA00C31031	BS.245599215	2024-05-14	晶艺半导体
43	LA10H11118	BS.245600779	2024-04-29	晶艺半导体
44	LA31U11125	BS.245600604	2024-04-19	晶艺半导体
45	LA00U11126	BS.245600795	2024-09-03	晶艺半导体
46	LA16S81120	BS.24560023X	2024-05-13	晶艺半导体
47	LA125AL 系列	BS.24552150X	2023-04-10	晶艺半导体
48	LA26S50408	BS.245536035	2023-12-18	晶艺半导体
49	LA29S20409	BS.245536248	2024-02-02	晶艺半导体
50	LA29S10409	BS.245536213	2024-02-02	晶艺半导体
51	LA36S10409	BS.245536159	2023-11-21	晶艺半导体
52	LA01H10415	BS.245536620	2024-01-26	晶艺半导体
53	LA12C10411	BS.245536590	2024-01-24	晶艺半导体
54	LA10C40411	BS.245536280	2023-11-23	晶艺半导体
55	LA71S10408	BS.245536051	2024-01-19	晶艺半导体
56	LA16S60411	BS.245536116	2023-02-03	晶艺半导体
57	LA91C40409	BS.245536183	2024-01-02	晶艺半导体
58	LA01H20416	BS.245536647	2024-01-26	晶艺半导体
59	LA15C10415	BS.245536612	2024-01-04	晶艺半导体
60	LA36S20409	BS.245536167	2023-11-21	晶艺半导体
61	LA18S51121	BS.235614238	2023-11-03	晶艺半导体
62	LA03S11121	BS.235614092	2023-08-17	晶艺半导体
63	LA10S11117	BS.235614300	2023-08-10	晶艺半导体
64	LA01M11120	BS.235614254	2023-11-03	晶艺半导体
65	LA18S31121	BS.235614173	2023-11-03	晶艺半导体
66	LA18S41121	BS.235614181	2023-11-03	晶艺半导体
67	LA20S11120	BS.235614033	2023-09-18	晶艺半导体
68	LA18S11121	BS.235614149	2023-11-03	晶艺半导体
69	LA03S21120	BS.235614114	2023-09-19	晶艺半导体
70	LA20M11120	BS.235614106	2023-11-14	晶艺半导体
71	LA12M41116	BS.235614076	2023-10-25	晶艺半导体
72	LA18S21121	BS.235614157	2023-11-03	晶艺半导体
73	LA65S11121	BS.23560691X	2023-10-08	晶艺半导体

序号	布图设计名称	登记号	创作完成时间	权利人
74	LA23M10721	BS.235565024	2023-01-18	晶艺半导体
75	LA31S10724	BS.235565113	2023-01-13	晶艺半导体
76	LA23M30724	BS.235565016	2023-01-18	晶艺半导体
77	LA10C20719	BS.23556561X	2023-03-03	晶艺半导体
78	LA23S20721	BS.23556544X	2023-02-22	晶艺半导体
79	LA28S20720	BS.23556558X	2023-05-06	晶艺半导体
80	LA61S10725	BS.235564850	2022-08-17	晶艺半导体
81	LA90C20721	BS.235565520	2023-05-25	晶艺半导体
82	LA10S10719	BS.235565636	2023-01-13	晶艺半导体
83	LA10S20720	BS.23556480X	2023-01-13	晶艺半导体
84	LA00C20719	BS.235565628	2022-01-06	晶艺半导体
85	LA23S30721	BS.235565431	2023-02-22	晶艺半导体
86	LA30S10720	BS.235565598	2023-06-16	晶艺半导体
87	LA12S10724	BS.23556513X	2023-01-10	晶艺半导体
88	LA32M10719	BS.235565652	2022-12-22	晶艺半导体
89	LA23S10721	BS.235565458	2023-02-22	晶艺半导体
90	LA16S30721	BS.235565482	2023-05-05	晶艺半导体
91	RN15S10719	BS.235565660	2022-12-08	晶艺半导体
92	LA23M20724	BS.235564982	2023-01-18	晶艺半导体
93	LA16S20721	BS.235565490	2023-05-05	晶艺半导体
94	LA28S10720	BS.235565555	2023-05-06	晶艺半导体
95	一种最高输入 18V 输出 5A 电流 COT 控制模式同步 BUCK 芯片	BS.225597268	2022-06-10	晶艺半导体
96	LA00S10217	BS.235513423	2022-03-02	晶艺半导体
97	LA25M10220	BS.235513393	2022-10-25	晶艺半导体
98	LA16S30221	BS.235513458	2021-09-29	晶艺半导体
99	LA21M20217	BS.235513156	2022-06-03	晶艺半导体
100	LA25S20220	BS.235513172	2022-01-07	晶艺半导体
101	LA26S20217	BS.235513210	2023-03-03	晶艺半导体
102	LA26S10217	BS.235513237	2022-12-08	晶艺半导体
103	RN14S10217	BS.235513431	2021-11-24	晶艺半导体
104	LA16S20221	BS.235513415	2021-09-29	晶艺半导体
105	LA16S40221	BS.235513253	2021-09-29	晶艺半导体
106	LA00S10217	BS.23551344X	2022-03-02	晶艺半导体
107	LA13S20216	BS.235513164	2022-12-19	晶艺半导体
108	RN21S10220	BS.235513466	2022-03-02	晶艺半导体
109	LA25S10220	BS.235513180	2022-01-07	晶艺半导体
110	LA16S50221	BS.235513245	2021-09-29	晶艺半导体
111	LA12M30220	BS.235513385	2022-03-25	晶艺半导体
112	一种最高输入 6V 输出 1A 电流 COT 控制模式 BUCK 芯片	BS.22559725X	2022-07-10	晶艺半导体
113	LA26S30217	BS.235510955	2023-02-24	晶艺半导体
114	一种 4A 1.6V~32V 宽输入范围高占空比 COT 控制模式同步 Buck 芯片	BS.225575183	2022-04-27	晶艺半导体

序号	布图设计名称	登记号	创作完成时间	权利人
115	一种带有可调恒流充电功能的 3A 同步 Buck 芯片	BS.215657500	2021-08-13	晶艺半导体
116	一种用于 30A/650V IPM 的低侧 IGBT 驱动芯片	BS.215657608	2020-03-16	晶艺半导体
117	一种 100V 高压 1A 异步 Buck 芯片	BS.215657535	2021-02-09	晶艺半导体
118	一种 3A 频率可调的 Cot 控制模式同步 Buck 芯片	BS.215657519	2021-06-30	晶艺半导体
119	一种原边反馈 Flyback 控制芯片	BS.215657659	2020-05-26	晶艺半导体
120	一种用于低功率 IPM 的高压半桥驱动芯片	BS.215657616	2020-03-10	晶艺半导体
121	一种副边反馈 Flyback 控制芯片	BS.215657551	2020-03-12	晶艺半导体
122	一种高侧 Buck 控制芯片	BS.215657667	2020-05-28	晶艺半导体
123	一种 3A COT 控制模式同步 Buck 芯片	BS.215657640	2020-06-28	晶艺半导体
124	一种双通道 1A 负载开关芯片	BS.215657543	2020-02-25	晶艺半导体
125	一种用于舞台灯/POS 机应用的步进电机驱动芯片	BS.215657586	2020-06-08	晶艺半导体
126	一种带自举功能的高压半桥驱动芯片	BS.21565756X	2019-06-17	晶艺半导体
127	一种用于投影仪应用的步进电机驱动芯片	BS.215657594	2020-06-08	晶艺半导体
128	一种带有低 THD 功能的原边反馈 Flyback 控制芯片	BS.215657675	2020-03-17	晶艺半导体
129	一种超低静态功耗 Buck 芯片	BS.215656024	2021-07-30	晶艺半导体
130	一种调速曲线可调的单相直流无刷电机驱动芯片	BS.215655990	2021-05-14	晶艺半导体
131	一种 2A COT 控制模式同步 Buck 芯片	BS.215657624	2020-06-23	晶艺半导体
132	一种 30A/650V IPM 的高侧驱动芯片	BS.215657578	2020-03-24	晶艺半导体
133	一种 1.2A 电流能力、超高电源抑制比、固定压差、高精度限流的负载开关芯片	BS.205602010	2020-05-28	晶艺半导体
134	一种可变速单相宽输入范围直流无刷电机驱动芯片	BS.205602053	2020-02-17	晶艺半导体
135	一种采用 CRM 和 DCM 相结合控制模式, 以实现全电压范围的电流失真低、功率因数接近 1 的功率矫正芯片	BS.205602037	2020-05-08	晶艺半导体
136	一种同步控制模式高输入宽范围 Buck 芯片	BS.195605071	2019-05-17	晶艺半导体
137	一种最大 5 节低功耗低漏电锂电池保护芯片	BS.19560508X	2019-05-17	晶艺半导体

商标权清单

序号	商标图案	商标名称	国际分类	商标状态	申请/注册号	注册公告日期	权利人
1		图形	9 类 科学仪器	已注册	69541878	2024-11-28	晶艺半导体
2	LASemi	LASEMI	35 类 广告销售	已注册	43408288	2020-11-28	晶艺半导体

域名清单

序号	域名	域名类型	注册日期	到期日	权利人
1	lasemi.cn	中国国家顶级域名证书	2022/2/18	2027/2/18	晶艺半导体
2	latticeart.com	国际顶级域名证书	2018/11/8	2026/11/8	晶艺半导体

长期待摊费用为待摊销的装修工程、框架开发、分选机、测试机板卡。

递延所得税资产为企业可抵扣暂时性差异相关的经济利益。

其他非流动资产为预付软件款。

（三）企业申报的表外资产的类型、数量

企业申报的表外资产为专利权 62 项、商标权 2 项、集成电路布图设计专有权 137 项、域名 2 项、合同权益 1 项，专利权、商标权、集成电路布图设计专有权、域名均已取得相应的权利证书。

（四）引用其他机构出具的报告结论所涉及的资产类型、数量和账面金额(或评估值)
本次评估未引用其他机构出具的报告结论。

四、价值类型

经与委托人沟通，考虑评估目的、市场条件、评估对象自身条件等因素，本次评估选取的价值类型为市场价值。

市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫的情况下，评估对象在评估基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

五、评估基准日

本项目评估基准日是 2026 年 02 月 28 日。

评估基准日是由委托人在考虑经济行为的实现、会计期末、利率和汇率变化等因素的基础上确定的。

六、评估依据

（一）经济行为依据

1. 《苏州锴威特半导体股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》。

（二）法律法规依据

1. 《中华人民共和国资产评估法》（2016 年 7 月 2 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过）；
2. 《中华人民共和国公司法》（1993 年 12 月 29 日第八届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，2023 年 12 月 29 日第十四届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修订）；
3. 《中华人民共和国证券法》（1998 年 12 月 29 日第九届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过，2019 年 12 月 28 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订）；

4. 《中华人民共和国专利法》（1984年3月12日第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过，2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议修正）；
5. 《中华人民共和国商标法》（1982年8月23日第五届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正）；
6. 《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号公布，证监会令第214号修订）；
7. 《上市公司收购管理办法》（证监会令第10号公布，证监会令第227号修正）；
8. 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》（中国证券监督管理委员会公告[2023]35号发布，中国证券监督管理委员会公告[2025]5号修改）；
9. 《非上市公众公司收购管理办法》（证监会令第102号公布，证监会令第227号修正）；
10. 其他有关法律法规。

（三）评估准则依据

1. 《资产评估基本准则》（财资[2017]43号）；
2. 《资产评估职业道德准则》（中评协[2017]30号）；
3. 《资产评估执业准则——资产评估程序》（中评协[2018]36号）；
4. 《资产评估执业准则——资产评估报告》（中评协[2018]35号）；
5. 《资产评估执业准则——资产评估委托合同》（中评协[2017]33号）；
6. 《资产评估执业准则——资产评估档案》（中评协[2018]37号）；
7. 《资产评估执业准则——利用专家工作及相关报告》（中评协[2017]35号）；
8. 《资产评估执业准则——企业价值》（中评协[2018]38号）；
9. 《资产评估执业准则——无形资产》（中评协[2017]37号）；
10. 《资产评估执业准则——机器设备》（中评协[2017]39号）；
11. 《资产评估执业准则——资产评估方法》（中评协[2019]35号）；
12. 《资产评估执业准则——知识产权》（中评协[2023]14号）；
13. 《资产评估机构业务质量控制指南》（中评协[2017]46号）；
14. 《资产评估价值类型指导意见》（中评协[2017]47号）；
15. 《资产评估对象法律权属指导意见》（中评协[2017]48号）；
16. 《专利资产评估指导意见》（中评协[2017]49号）；
17. 《商标资产评估指导意见》（中评协[2017]51号）；

18. 其它相关行业规范。

（四）权属依据

1. 专利证书；
2. 商标注册证；
3. 域名证书；
4. 集成电路布图设计登记证书；
5. 重要资产购置合同或凭证；
6. 其他权属证明文件。

（五）取价依据

1. 中央国债登记结算有限责任公司编制，并在中国债券信息网发布的国债到期收益率数据；
2. 中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）；
3. 中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的汇率中间价；
4. 企业提供的部分合同、协议等；
5. 企业管理层提供的未来收益预测资料；
6. 国家宏观经济、行业、区域市场及企业统计分析资料；
7. 同行业可比上市公司公开发布的相关资料；
8. 其他相关取价依据。

（六）其他参考依据

1. 企业提供的资产清单和评估申报表；
2. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
3. 企业提供的原始财务报表、账册、会计凭证；
4. 企业提供的经营信息和资料；
5. 评估人员现场调查记录及收集的其他相关信息和资料；
6. 金证（上海）资产评估有限公司技术资料库；
7. 评估基准日有效的企业会计准则及应用指南；
8. 其它有关参考依据。

七、评估方法

（一）评估方法选择

企业价值评估的基本方法主要有收益法、市场法和资产基础法。

企业价值评估中的收益法，是指将预期收益资本化或者折现，确定评估对象价值的评估方法。收益法常用的具体方法包括股利折现法和现金流量折现法。

企业价值评估中的市场法，是指将评估对象与可比上市公司或者可比交易案例进行比较，确定评估对象价值的评估方法。市场法常用的两种具体方法是上市公司比较法和交易案例比较法。

企业价值评估中的资产基础法，是指以被评估单位评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法。

《资产评估执业准则——企业价值》规定，执行企业价值评估业务，应当根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析收益法、市场法、资产基础法三种基本方法的适用性，选择评估方法。

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集情况等相关条件，以及三种评估基本方法的适用条件，本次评估选用的评估方法为资产基础法及市场法。评估方法选择理由如下：

1. 资产基础法适用性分析

被评估单位评估基准日资产负债表中各项表内资产、负债及重要的表外资产可被识别并可采用适当的方法单独进行评估，故整体上适用资产基础法。

2. 收益法适用性分析

被评估单位是国内领先的电机驱动功率模块和电源管理模拟芯片等产品的研发、设计和销售企业，主要产品包括 IPM 模块、DC-DC 芯片等，属于 Fabless 芯片设计企业。这类轻资产企业将制造、封装、测试委外，注重研发，其核心价值在于技术、研发团队、客户导入、产品平台和未来国产替代机会，而这些往往难以直接从报表资产或短期利润中体现。收益法依赖未来收入、利润、现金流和折现率的可靠预测，但芯片设计行业技术迭代快、研发投入高、产品导入周期长、收益法容易出现“成本端反映研发投入、收入端未充分反映未来机会”的不匹配问题，未来收益预测和测算风险衡量难以同时进行合理预计，不适用盈利模式非线性的新经济企业，因此不宜采用收益法进行评估。

3. 市场法适用性分析

被评估单位主要从事于电机驱动功率模块和电源管理模拟芯片等产品的研发、设计和销售，属于集成电路行业芯片设计企业，经查询，模拟芯片行业存在较多的同行业上市公司，可比公司公开市场交易价格、经营情况和财务状况等相关必要的数据公开、可查询。因此，本次适宜采用整体市场法评估。

被评估单位的定制化量产业务稳定，历史期为企业持续稳定的现金流以供技术开发及设计业务开拓，考虑到该业务的服务模式、收入成长性与芯片设计业务存在差异，其价值驱动因素亦有所不同。若将定制化量产业务收入乘以市场法价值比率放大，可能导致整体企业价值被高估。因此谨慎起见，考虑到定制化量产业务开展以来，稳步发展，企

业产品、技术、客户关系、供销体系稳定，企业管理可对其未来年度经营收益及成本费用等相关参数进行估测，获得预期收益所承担的风险也可以量化。故结合可预见的供应体系及客户需求，采用收益法有限年对该业务收益进行预测并折现，视同货币资金或非经营性资产在基准日加回，收益期为评估基准日至 2027 年底。

（二）市场法简介

从我国 A 股上市公司中选择与被评估单位属于同一行业，或者受相同经济因素的影响的上市公司。通过比较被评估单位与上述上市公司在业务结构、经营模式、经营规模、资产配置和使用情况、所处经营阶段、成长性、经营风险、财务风险等因素后，进一步筛选得到与被评估单位进行比较分析的可比企业。

本次市场法评估对于可比上市公司的选取标准如下：

- （1）在中国国内 A 股上市，且截至评估基准日至少已上市 1 年。
- （2）采用 Fabless 经营模式，专注于芯片研发与销售，晶圆制造、封装测试等生产环节主要通过外部供应商完成。
- （3）与评估对象同属于模拟芯片行业，且主要经营业务为电源管理芯片，营业收入构成中电源管理类的占比不低于 70%。
- （4）根据相关上市公司公告的文件，评估基准日近期未发生重大资产重组等可能使股票价格存在异常波动的重大事件。
- （5）由于本次评估的价值比率采用了动态 EV/S，计算可比公司的价值比率需要用到可比公司的预测收入数据，故将同花顺 iFind 中显示预测收入数据缺失的公司剔除。
- （6）晶艺半导体的 DC-DC 稳压供电类产品集中在 70-100V 中低压区段、电机驱动类主要为 400-750V 的高压产品，电源管理芯片领域消费级低压产品市场竞争更为激烈。产品的主要应用领域包括家电、安防摄像头、智能电表、电动两轮车等工业及消费市场。对于可比公司的产品及其应用领域的相似性做进一步分析筛选。

根据上述选取标准，最终选取得到可比上市公司如下：

证券代码	证券简称	上市日期	主营业务	公司简介
688141.SH	杰华特	2022-12-23	模拟集成电路的研发与销售。	杰华特微电子股份有限公司的主营业务是模拟集成电路的研发与销售。公司的主要产品是 AC-DC 芯片、DC-DC 芯片、线性电源芯片、电池管理芯片、检测芯片、接口芯片、转换器芯片、时钟芯片、线性芯片、传感器芯片、高速信号芯片、驱动芯片、功率产品。

证券代码	证券简称	上市日期	主营业务	公司简介
688173.SH	希荻微	2022-01-21	电源管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售。	希荻微电子集团股份有限公司的主营业务是包括电源管理芯片和信号链芯片在内集成电路的研发、设计和销售。公司的主要产品是DC/DC芯片、锂电池充电管理芯片、高集成度PMIC芯片、端口保护和信号切换芯片、电源转换芯片、音圈马达驱动芯片、传感器芯片。
688209.SH	英集芯	2022-04-19	电源管理、快充协议芯片的研发和销售。	深圳英集芯科技股份有限公司的主营业务是电源管理、电池管理、数模混合SoC等相关芯片的研发、设计与应用。公司的主要产品是电源管理芯片类、电池管理芯片类、数模混合SoC芯片类。
688508.SH	芯朋微	2020-07-22	电源管理集成电路的研发和销售。	无锡芯朋微电子股份有限公司的主营业务是提供电源和电机系统芯片及解决方案。公司的主要产品是AC-DC电源产品线、DC-DC电源产品线、DigitalPMIC电源产品线、驱动产品线、功率器件产品线和功率模块产品线。

2.分析调整财务报表

将被评估单位与可比企业的业务情况和财务情况进行比较和分析，并做必要的调整，以使可比企业的与被评估单位的各项数据口径更加一致、可比。

3.选择、计算、调整价值比率

根据被评估单位所属行业特征、所处经营阶段等因素，在盈利比率、资产比率、收入比率和其他特定比率中选择适用的价值比率，并计算各可比上市公司的价值比率。接下来，分析可比企业与被评估单位的主要差异因素，建立指标修正体系，将可比企业与被评估单位相关财务数据和经营指标进行比较，并对差异因素进行量化调整，将可比交易案例中的价值比率修正至适用于被评估单位的水平。

本次市场法评估选取的价值比率为用企业价值与营业收入比率 (EV/S)，理由如下：

(1)被评估单位属于半导体行业，利润指标容易受行业周期波动的影响，代表性不强。被评估单位属于轻资产企业，采用资产指标难以衡量企业真实价值。

(2)随着近几年的发展，被评估单位营业收入已初具规模，部分细分领域市场份额已形成竞争优势。考虑到我国半导体行业整体发展尚处于追赶状态，营业收入更能反映企业在行业内的影响力，也更能体现企业价值。

(3)与此同时，企业价值指标 (EV) 属于整体价值，不仅仅包括股权价值，还包括债权价值，能充分反映企业经营性核心资产的价值。本次评估采用企业价值与营业收入比率 (EV/S)，可以降低可比上市公司与被评估单位因资本结构等方面存在差异而产生的影响，有助于分析被评估单位价值基础的稳定性和可靠性，又能合理反应被评估单位的市场价值。

(4) 被评估单位作为轻资产、高研发投入的半导体设计企业，公司的半桥智能功率模块（IPM）历经数年的技术积累及业务布局，凭借其小体积、低温升、低电磁干扰、高可靠性、PCB 布局灵活易加工等性能优势已成功导入白电主流厂商，该业务线 2025 年实现翻倍增长收入突破亿元，当前处于技术成果集中转化，收入高速增长的关键期。静态或历史数据低估了其业绩表现，且 2026 年收入可结合期后财务数据及订单较为可靠的估计。因此，对于被评估单位这种处于快速成长期且研发投入较大的轻资产公司，动态价值比率是衡量其“未来成长确定性”与“市场规模扩张力”的优选指标。

本次市场法评估量化调整的可比企业和被评估单位间差异因素包括经营规模、盈利能力、运营能力、偿债能力、成长能力、研发能力等。各项修正因素采用的具体评价指标和修正方式如下：

企业规模：本次选用总资产规模作为衡量企业规模的指标。以被评估单位为基准系数 100，资产规模超过被评估单位的可比公司向上进行修正，反之则向下进行修正。

成长能力：本次选用营业收入增长率指标作为发展能力的衡量指标。以被评估单位为基准系数 100，营业收入增长率超过被评估单位的可比公司向上进行修正，反之则向下进行修正。

偿债能力：本次选用资产负债率、流动比率指标。以被评估单位为基准系数 100。其中，资产负债率指标超过被评估单位的可比公司向下进行修正，反之则向上进行修正；流动比率指标超过被评估单位的可比公司向上进行修正，反之则向下进行修正。

运营能力：本次选用存货周转率、应收账款周转率、应付周转率指标。以被评估单位为基准系数 100，营运能力指标超过被评估单位的可比公司向上进行修正，反之则向下进行修正。

盈利能力：本次选用销售毛利率、净资产收益率指标作为盈利能力的衡量指标。以被评估单位为基准系数 100，盈利能力指标超过被评估单位的可比公司向上进行修正，反之则向下进行修正。

研发能力：本次选用研发费用率作为衡量研发投入的指标。以被评估单位为基准系数 100，研发费用率超过被评估单位的可比公司向上进行修正，反之则向下进行修正。

4.运用价值比率

对于企业整体价值比率，将调整后的价值比率与被评估单位相应的财务数据或指标相乘，扣减付息债务价值和少数股东权益价值，并对被评估单位的非经营性资产、负债和溢余资产价值进行调整，计算得到被评估单位的股东全部权益价值。

5.对流动性及控制权的考虑

本次市场法评估采用上市公司比较法，由于选取的可比公司为上市公司，而被评估单位为非上市公司，评估中考虑了流动性对评估对象价值的影响。缺乏流动性折扣率根据同

行业上市公司新股 IPO 的发行定价与该股票正式上市后的第 90 日、第 120 日、第 180 日交易价格之间的差异计算，并取最大值。

由于中国市场缺乏比较可靠的控制权溢价率或缺乏控制权折价率数据，本次市场法评估未考虑控制权对评估对象价值的影响。

（三）资产基础法简介

1. 流动资产

评估范围内的流动资产包括货币资金、应收账款、预付款项、其他应收款、存货、一年内到期的非流动资产、其他流动资产。

（1）货币资金

包括银行存款、其他货币资金，按核实无误后的账面值作为评估值。其中外币资金按评估基准日的国家外汇牌价折算为人民币值。

（2）应收款项

包括应收账款、其他应收款。对于各种应收款项，在核实无误的基础上，借助于历史资料和现场调查了解的情况，具体分析数额、欠款时间和原因、款项回收情况、欠款人资金、信用、经营管理现状等，根据每笔款项可能收回的数额确定评估值。对于有充分理由相信全都能收回的，按全部应收款额计算评估值；对于很可能收不回部分款项的，在难以确定收不回账款的数额时，按照账龄分析法，估计出这部分可能收不回的款项，作为风险损失扣除后计算评估值，账面上的“坏账准备”科目评估为零。

（3）预付款项

根据所能收回的相应货物形成资产或权利的价值确定评估值。对于能够收回相应货物的或权益的，按核实后的账面值作为评估值。对于有确凿证据表明收不回相应货物，也不能形成相应资产或权益的预付账款，其评估值为零。

（4）存货

包括原材料、在库周转材料、委托加工物资、产成品、发出商品。

对于原材料和在库周转材料，根据清查核实后的数量乘以现行市场购买价，再加上合理的运杂费、损耗、验收整理入库费及其他合理费用确定评估值。对其中失效、变质、残损、报废、无用的，通过分析计算，扣除相应贬值额（保留变现净值）后，确定评估值。

对于委托加工物资，均为半成品状态，根据产品销售毛利率水平折合其不含税销售价格后扣减销售费用、全部税金和部分税后净利润后确定评估值。

对于产成品，按核实后的数量乘以现行市场购买价，再加上合理的运杂费、损耗、验收整理入库费及其他合理费用，得出评估值。对其中失效、变质、残损、报废、无用的，通过分析计算，扣除相应贬值额（保留变现净值）后，确定评估值。

对于发出商品，根据其不含税出厂销售价格减去部分销售费用、全部税金和适当数额的税后净利润确定评估值。

(5) 一年内到期的非流动资产

在了解一年内到期的非流动资产的产生原因、形成过程并核实金额的准确性的基础上，根据其尚存受益的权利或可收回的资产价值金额确定评估值。

(6) 其他流动资产

在了解其他流动资产的产生原因、形成过程并核实金额的准确性的基础上，根据其尚存受益的权利或可收回的资产价值金额确定评估值。

2. 长期股权投资

对于具备单独评估条件的长期股权投资，采用资产基础法对被投资单位进行整体评估，并以被投资单位股东权益评估值乘以持股比例确定评估值。

3. 固定资产

(1) 设备类

根据各类设备的特点、价值类型、资料收集情况等相关条件，主要采用成本法评估。

① 成本法

成本法估值的基本公式如下：

$$\text{评估值} = \text{重置成本} \times \text{综合成新率}$$

A. 重置成本的确定

根据《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税[2008]170号）、《关于固定资产进项税额抵扣问题的通知》（财税[2009]113号）和《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号），对于增值税一般纳税人，购置符合增值税抵扣条件的设备，设备重置成本应扣除相应的可抵扣增值税税额。

a) 机器设备

机器设备的重置成本计算公式如下：

重置成本 = 设备现价 + 运杂费 + 安装费 + 基础费 + 其它合理费用 + 资金成本 - 可抵扣增值税额

b) 电子及其他设备

电子及其他设备的重置成本计算公式如下：

重置成本 = 设备现价 - 可抵扣增值税额

B. 综合成新率的确定

a) 机器设备

对于价值量较大的机器设备，在年限法理论成新率的基础上，再结合各类因素进行调整，最终确定设备的综合成新率，计算公式如下：

$$\text{综合成新率} = \text{理论成新率} \times \text{调整系数}$$

其中：

理论成新率 = (经济使用年限 - 已使用年限) ÷ 经济使用年限 × 100%

调整系数 = $K_1 \times K_2 \times K_3 \times K_4 \times K_5$

各项调整因素包括设备的原始制造质量 (K1)、维护保养情况 (K2)、设备的运行状态及故障频率 (K3)、设备的利用率 (K4)、设备的环境状况 (K5)。

b) 电子及其他设备

对于价值量较小的一般电子及其他设备，直接采用年限法确定成新率，计算公式如下：

成新率 = (经济使用年限 - 已使用年限) ÷ 经济使用年限 × 100%

4. 在建工程

对于开工时间距基准日半年内的在建工程项目，在核实后的账面值基础上，按剔除其中不合理支出后的余额确定评估值。被评估单位的在建工程-设备仅为购入的暂未安装的柜机空调，金额较小，本次评估按照账面值确认评估值。

5. 无形资产

(1) 其他无形资产——软件类

对于已没有市场交易的通用软件以及难以向软件开发商询价的定制软件，在原始购置成本基础上，参考同类软件市场价格变化趋势结合经济使用寿命作为评估值。

(2) 其他无形资产——关键核心技术

无形资产评估的方法通常有成本法、市场法和收益法三种。

成本法即根据无形资产的成本来确定无形资产价值的方法。这里的成本是指重置成本，就是将当时所耗用的材料、人工等开支和费用用现在的价格来进行计算而求得的成本，或者用现在的方法来取得相同功能的无形资产所需消耗的成本。

市场法即根据类似无形资产的市场价经过适当的调整，来确定无形资产价值的方法。由于我国的市场经济尚不成熟，无形资产的交易更少，因此无形资产评估中市场法的使用也很少。且由于技术具有较强的独特性，不同技术进行类比的要求和难度较大，难以收集到类似技术的交易案例及相关案例的具体信息，故本次未采用市场法评估。

收益法是将无形资产在未来收益期内产生的收益，按一定的折现率折算成现值，来求得无形资产价值的方法。由于被评估单位的专利及集成电路设计图专有权大部分与电机驱动业务、电源管理业务发展相关，未来收益受到半导体行业整体发展进程与企业自身发展战略调整的双重影响，难以精确测算各年度收益数据，未来收益预测和测算风险衡量缺乏可靠估计基础，因此不宜采用收益法进行评估。

成本法是通过确定无形资产的重置成本及合理回报，并考虑贬值情况，来确定无形资产的评估值。电机驱动业务、电源管理业务的相关核心技术主要系企业自研形成，其研发投入较高，持续高投入形成的相关技术和专利在未来具有长期应用价值。被评估单位自 2019

年成立之日起开始陆续开发，因此本次研发投入统计起始期划定为 2019 年。考虑到开发形成过程中的直接成本和间接成本资料可以从企业获得，故宜采用成本法进行评估。

$$\text{技术评估值} = \text{重置成本} \times (1 - \text{贬值率})$$

(3) 其他无形资产——商标

对于商标，本次采用成本法评估，基本公式如下：

$$\text{商标评估值} = \text{重置成本} \times (1 - \text{贬值率})$$

(4) 其他无形资产——域名

对于域名，本次采用成本法评估，基本公式如下：

$$\text{域名评估值} = \text{重置成本} \times (1 - \text{贬值率})$$

(5) 其他无形资产-合同权益

对于合同权益，本次采用收益法—多期超额收益折现法评估。本次评估以合同权益所产生的未来盈利预测数据为计算基础，预测相关客户资源在未来收益期的现金流贡献。本次收益采用息税前利润口径，再扣减其他所有有形资产、无形资产的相关现金流贡献，确定仅属于合同权益的现金流，结合技术经济年限预测其现金流的衰减情况，最后将合同权益预期合理寿命期内的各期现金流折现，确定评估值基本公式如下：

$$p = \sum_{i=1}^n \frac{F_i \times (1 - T_i)}{(1 + r)^i}$$

其中：P— 委估无形资产的价值

Fi— 委估无形资产对应第 i 期的超额收益

n— 收益期限

r— 折现率

6. 使用权资产

对于相关租赁合同中的租金水平与同区域内类似房地产的市场租金水平基本相符的使用权资产，以核实后的账面值作为评估值。

7. 长期待摊费用

对于核实无误的、基准日以后尚存资产或权利的长期待摊费用，在核实受益期和受益额无误的基础上按尚存受益期确定评估值。

8. 递延所得税资产

在了解递延所得税资产的产生原因、形成过程并核实金额准确性的基础上，以预计可实现的与可抵扣暂时性差异相关的经济利益确认评估值。

9. 其他非流动资产

在了解其他非流动资产的产生原因、形成过程并核实金额的准确性的基础上，根据其尚存受益的权利或可收回的资产价值金额确定评估值。

10. 负债

评估范围内的负债包括短期借款、应付票据、应付账款、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、租赁负债、递延收益，根据企业实际需要承担的负债项目和金额确定评估值。

八、评估程序实施过程 and 情况

自接受资产评估业务委托起至出具资产评估报告，主要评估程序实施过程和情况如下：

（一）明确业务基本事项

与委托人进行接洽，明确以下资产评估业务基本事项：（1）委托人、产权持有人和委托人以外的其他资产评估报告使用人；（2）评估目的；（3）评估对象和评估范围；（4）价值类型；（5）评估基准日；（6）资产评估项目所涉及的需要批准的经济行为的审批情况；（7）资产评估报告使用范围；（8）资产评估报告提交期限及方式；（9）评估服务费及支付方式；（10）委托人、其他相关当事人与资产评估机构及其资产评估专业人员工作配合和协助等需要明确的重要事项。

（二）订立业务委托合同

在业务基本事项的基础上，对专业能力、独立性和业务风险进行综合分析和评价。在确保受理该资产评估业务满足专业能力、独立性和业务风险控制要求的情况下，与委托人签订资产评估委托合同，约定资产评估机构和委托人权利、义务、违约责任和争议解决等内容。

（三）编制资产评估计划

根据资产评估业务具体情况编制资产评估计划，包括资产评估业务实施的主要过程及时间进度、人员安排等。

（四）进行评估现场调查

采用询问、访谈、核对、监盘、勘查等手段，对评估对象进行现场调查，获取评估业务需要的资料，了解评估对象现状，关注评估对象法律权属。

（五）收集整理评估资料

根据资产评估业务具体情况，收集资产评估业务需要的资料，主要包括：（1）委托人或者其他相关当事人提供的涉及评估对象和评估范围等资料；（2）从政府部门、各类专业机构以及市场等渠道获取的其他资料。采用观察、询问、书面审查、实地调查、查询、函证、复核等方式，对资产评估活动中使用的资料进行核查验证。根据资产评估业务具体情况对收集的评估资料进行分析、归纳和整理，形成评定估算和编制资产评估报告的依据。

（六）评定估算形成结论

根据评估目的、评估对象、价值类型、资料收集等情况，分析市场法、收益法和成本法三种资产评估基本方法及衍生方法的适用性，选择评估方法。在此基础上，根据所采用的

评估方法，选取相应的公式和参数进行分析、计算和判断，形成测算结果，并对形成的测算结果进行综合分析，形成评估结论。

（七）编制出具评估报告

资产评估专业人员在评定、估算形成评估结论后，编制初步资产评估报告。资产评估机构按照法律、行政法规、资产评估准则和资产评估机构内部质量控制制度，对初步资产评估报告进行内部审核。项目负责人根据内部审核意见对初步资产评估报告进行修改和完善后，在不影响对评估结论进行独立判断的前提下，与委托人或者委托人同意的其他相关当事人就资产评估报告有关内容进行沟通，根据沟通结果对资产评估报告进行合理完善后，出具并提交正式资产评估报告。

九、评估假设

本资产评估报告分析估算采用的假设条件如下：

（一）一般假设

1.交易假设：即假定所有待评估资产已经处在交易的过程中，评估师根据待评估资产的交易条件等模拟市场进行估价。交易假设是资产评估得以进行的一个最基本的前提假设。

2.公开市场假设：即假定资产可以在充分竞争的市场上自由买卖，其价格高低取决于一定市场的供给状况下独立的买卖双方对资产的价值判断。

3.持续经营假设：即假定一个经营主体的经营活动可以连续下去，在未来可预测的时间内该主体的经营活动不会中止或终止。

（二）特殊假设

1.假设评估基准日后被评估单位所处国家和地区的法律法规、宏观经济形势，以及政治、经济和社会环境无重大变化；

2.假设评估基准日后国家宏观经济政策、产业政策和区域发展政策除公众已获知的变化外，无其他重大变化；

3.假设与被评估单位相关的税收政策、信贷政策不发生重大变化，税率、汇率、利率、政策性征收费用率基本稳定；

4.假设评估基准日后被评估单位的管理层是负责的、稳定的，且有能力担当其职务；

5.假设被评估单位完全遵守所有相关的法律法规，不会出现影响公司发展和收益实现的重大违规事项；

6.假设委托人及被评估单位提供的基础资料、财务资料和经营资料真实、准确、完整；

7.假设可比企业交易价格公允，相关财务数据和其他信息真实可靠；

8.假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对被评估单位造成重大不利影响；

9.假设评估基准日后被评估单位采用的会计政策与编写本资产评估报告时所采用的会计政策在重要方面基本保持一致；

10.假设评估基准日后被评估单位在现有管理方式和管理水平的基础上，经营范围、方式、业务结构与目前基本保持一致，不考虑未来可能由于管理层、经营策略以及商业环境不可预见性变化的潜在影响；

11.假设被评估单位拥有的各项经营资质，在符合现有续期条件下未来到期后可以顺利续期；

12.假设被评估单位在符合现有高新企业认定条件下，未来持续被认定为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠税率；

13.假设评估基准日后被评估单位的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出。

本评估报告评估结论在上述假设条件下在评估基准日时成立，当上述假设条件发生较大变化时，签字资产评估师及本评估机构将不承担由于假设条件改变而推导出不同评估结论的责任。

十、评估结论

(一) 资产基础法评估结果

经资产基础法评估，评估基准日被评估单位总资产账面价值 51,926.96 万元，评估值 100,854.88 万元，增值额 48,927.92 万元，增值率 94.22%。总负债账面价值 15,875.39 万元，评估值 15,875.39 万元，无增减值变动。所有者权益账面价值 36,051.57 万元，评估值 84,979.49 万元，评估增值 48,927.92 万元，增值率 135.72%。

资产基础法评估结果汇总如下表所示：

资产基础法评估结果汇总表

评估基准日：2026 年 02 月 28 日

金额单位：人民币万元

序号	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
1	流动资产	48,913.16	53,690.03	4,776.87	9.77
2	非流动资产	3,013.80	47,164.85	44,151.05	1,464.96
3	债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
4	其他债权投资	0.00	0.00	0.00	0.00
5	长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
6	长期股权投资	82.99	4,826.37	4,743.38	5,715.50
7	其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00	0.00
8	其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
9	投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00
10	固定资产	1,068.10	1,636.57	568.47	53.22
11	在建工程	1.29	1.29	0.00	0.00

序号	项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		A	B	C=B-A	D=C/A×100%
12	生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00
13	油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
14	使用权资产	1,182.99	1,182.99	0.00	0.00
15	无形资产	129.78	39,182.72	39,052.94	30,091.70
16	开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17	商誉	0.00	0.00	0.00	0.00
18	长期待摊费用	45.50	45.50	0.00	0.00
19	递延所得税资产	499.14	285.40	-213.74	-42.82
20	其他非流动资产	4.01	4.01	0.00	0.00
21	资产总计	51,926.96	100,854.88	48,927.92	94.22
22	流动负债	14,674.87	14,674.87	0.00	0.00
23	非流动负债	1,200.51	1,200.51	0.00	0.00
24	负债合计	15,875.39	15,875.39	0.00	0.00
25	所有者权益	36,051.57	84,979.49	48,927.92	135.72

(二) 市场法评估结果

经市场法评估，被评估单位评估基准日股东全部权益评估值为 165,000.00 万元，比审计后母公司账面所有者权益增值 128,948.43 万元，增值率 357.68%；比审计后合并报表归属于母公司所有者权益增值 124,182.43 万元，增值率 304.24%。

(三) 评估结论

资产基础法评估得出的股东全部权益价值为 84,979.49 万元，市场法评估得出的股东全部权益价值为 165,000.00 万元，两者相差 80,020.51 万元。

资产基础法是从资产的再取得途径考虑的，反映的是企业现有资产的重置价值；市场法是从可比公司的市场估值倍数角度考虑的，反映了当前现状企业的市场估值水平。两种评估方法对企业价值的显化范畴不同，资产基础法仅能对各单项有形资产和可辨认的无形资产进行评估，不能完全体现各单项资产互相匹配和有机组合因素的整合效应对企业价值的贡献；而市场法通过可比企业的股权价值结合其他相关资料分析得出被评估单位的股权价值，价值内涵能够包括企业不可辨认的无形资产，以及各单项资产整合效应的价值，因此评估结果比资产基础法高。

被评估单位属于模拟芯片设计企业，企业的主要价值除固定资产、营运资金等有形资源之外，还应包含企业拥有的如客户资源、管理能力和人才积累等重要的无形资源的贡献。由于市场法采用的数据直接来源于资本市场，随着我国半导体行业的快速发展，国内 A 股市场上出现了较多的与被评估单位相似的芯片设计上市公司，市场法数据来源公开透明、真实可靠且披露及时，其成熟的估值体系能够更好的体现被评估单位股权价值。考虑到市

场法采用的数据更加真实、可靠，评估结果更加客观，且我国的资本市场也日臻成熟，相对稳定的股市也提供了市场法定价的基础，故本次选择市场法评估结果作为最终的评估结论。

根据上述分析，本评估报告评估结论采用市场法评估结果，即：被评估单位评估基准日的股东全部权益价值评估结论为人民币 165,000.00 万元，大写壹拾陆亿伍仟万元整。

本评估结论在市场法评估中考虑了流动性对评估对象价值的影响；由于中国市场缺乏比较可靠的控制权溢价率或缺乏控制权折价率数据，本评估结论没有考虑控制权对评估对象价值的影响。

（四）评估结论的使用有效期

本评估报告所揭示的评估结论仅对评估报告中描述的经济行为有效，评估结论使用有效期为自评估基准日起一年，即自评估基准日 2026 年 02 月 28 日至 2027 年 02 月 27 日。

（五）评估结论公允性分析

根据近年来公开市场信息，筛选的同行业可比交易案例情况具体如下：

证券简称	标的简称	标的业务	评估值 (万元)	静态 PS	动态 PS	静态 PB
概伦电子	锐成芯微	提供集成电路产品所需的半导体 IP 设计、授权及相关服务	157,479.00	6.32	-	2.04
概伦电子	纳能微	提供集成电路产品所需的半导体 IP 设计、授权及相关服务	60,000.00	9.06	8.15	4.58
中微公司	众硅	高端化学机械抛光和化学机械平坦化（CMP）设备的研发、生产及销售，并为客户提供 CMP 设备的整体解决方案。	250,140.00	10.25	8.93	3.32
思瑞浦	创新微	高精度、低功耗电池管理及高效率、高密度电源管理芯片研发和销售，主要产品包括锂电保护芯片、AC/DC、功率器件等	106,000.00	4.19	2.72	4.00
希荻微	诚芯微	模拟及数模混合集成电路研发、设计和销售；主要产品包括电源管理芯片、电机类芯片、MOSFET 和电池管理芯片等多种集成电路产品	31,100.00	1.57	1.54	3.03
泰凌微	磐启微	低功耗无线物联网芯片的研发、设计和销售	85,000.00	6.00	3.70	6.77
华海诚科	衡所华威	半导体芯片封装材料研发、生产和销售	165,800.00	3.54	3.04	4.11
均值				5.85	4.68	3.98
中位数				6.00	3.37	4.00
本次交易				4.72	2.93	4.31

注：概伦电子收购锐成芯微案例中，未披露标的公司评估基准日后一个会计年度的收入，因此无法计算动态市销率。

本次交易，晶艺半导体 100% 股东权益评估值为 16.50 亿元，对应静态市销率为 4.72 倍、动态市销率为 2.93 倍，低于可比交易案例平均值和中位数；同时，晶艺半导体市净率为 4.31 倍，与可比交易案例市净率平均值、中位数较为接近。

十一、特别事项说明

以下为在评估过程中已发现可能影响评估结论但非评估人员执业水平和能力所能评定估算的有关特别事项，评估报告使用人应关注以下特别事项对评估结论和经济行为产生的影响。

（一）权属资料不完整或者存在瑕疵的情形

截至评估基准日，企业存在以下质押事项：

序号	质权人	出质人	出质知产类型	名称	出质登记号	出质公告日
1	成都农村商业银行股份有限公司金牛支行	晶艺半导体有限公司	专利	基于 FLYBACK 的功率因数校正电路的控制电路和方法	Y2025980027967	2025-07-29

经与被评估单位了解，上述知识产权质押系向成都农村商业银行股份有限公司金牛支行申请 1,000.00 万元借款，考虑到被评估单位货币资金充足，预期不会发生短期借款到期无法偿还的可能，本次评估未考虑上述质押事项对评估结论可能产生的影响。

除此之外，本次评估未发现其他权属资料不全面或者存在瑕疵的情形。

（二）委托人未提供的其他关键资料情况

本次评估无委托人未提供的关键资料。

（三）未决事项、法律纠纷等不确定因素

本次评估未发现评估基准日存在未决事项、法律纠纷等不确定因素。

（四）重要的利用专家工作及相关报告情况

本次评估历史年度及评估基准日的账面值利用了以下报告：

1. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《晶艺半导体有限公司 2024-2026 年 2 月审计报告》，报告编号为“天健审〔2026〕17359 号”，报告出具日为 2026 年 08 月 05 日，审计意见为无保留意见。

2. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《晶艺半导体有限公司 2024-2026 年 2 月模拟审计报告》，报告编号为“天健审〔2026〕17360 号”，报告出具日为 2026 年 08 月 05 日，审计意见为无保留意见。

(五) 重大期后事项

1.2026年1月6日,晶艺半导体召开股东会,全体股东一致同意晶艺半导体注册资本由5,333.4111万元减少至5,002.7596万元,其中:美的投资减少102.0408万元注册资本并退出晶艺半导体;天利投资减少21.8659万元注册资本;高鹏翼盛减少85.2770万元注册资本;高鹏联盛减少24.0525万元注册资本;腾元投资减少10.933万元注册资本;易荣坤减少16.3994万元注册资本;上海芯珪减少70.0829万元注册资本。本次减资以各股东的投资成本为基础协商定价,晶艺半导体已于2026年1月向上述股东支付合计为24.145.83万元的回购款。2026年3月4日,晶艺半导体完成了本次变更的工商变更登记。本次股权回购涉及的减资款项已于评估基准日前支付,该事项不影响评估结论。

2.截至评估基准日被评估单位股东未完全出资,认缴出资金额5,333.4111万元,实缴金额5,313.4111万元。2026年3月3日,易坤投资151.20万元以货币形式补足实缴注册资本20万元。被评估单位评估基准日股东全部权益市场价值未考虑未来补足认缴出资额对于股东全部权益价值的影响。

(六) 评估程序受限的有关情况、评估机构采取的弥补措施及对评估结论影响的情况

本次评估无评估程序受限情况。

(七) 其他需要说明的事项

被评估单位子公司香港晶艺半导体有限公司为贸易公司。基于香港子公司的业务性质与资产状况,本次评估未对香港子公司进行现场调查,主要通过母公司现场尽职调查及统一管理平台对香港子公司的权属资料、会计资料、报表等进行了清查核实,未进行境外现场调查不会对评估结论产生重大影响。

本资产评估报告中,所有以万元为金额单位的表格或者文字表述,若存在合计数与各项数值之和出现尾差的情况,均系四舍五入原因造成。

评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见,并不承担相关当事人决策的责任。评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

委托人及被评估单位所提供的资料是进行本次资产评估的基础,委托人和被评估单位应对所提供资料的真实性、合法性和完整性承担责任。

十二、资产评估报告使用限制说明

本资产评估报告的使用范围如下:仅供委托人和资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人使用;仅限用于本资产评估报告载明的评估目的;仅限在本资产评估报告载明的评估结论使用有效期内使用;未征得本资产评估机构同意,资产评估报告的内容不得被摘抄、引用或者披露于公开媒体,法律、行政法规规定以及相关当事人另有约定的除外。

委托人或者其他资产评估报告使用人未按照法律、行政法规规定和资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告的,资产评估机构及其资产评估师不承担责任。

除委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报告使用人之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。

资产评估报告使用人应当正确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认为是对其评估对象可实现价格的保证。

本资产评估报告经资产评估师签字、评估机构盖章后方可正式使用。

十三、资产评估报告日

资产评估报告日为 2026 年 08 月 05 日。

（此页以下无正文）

(本页无正文, 系金证评报字【2026】A0554 号资产评估报告签章页)

资产评估机构: 金证(上海)资产评估有限公司



资产评估师:

蒋霄骑

冯赛平

正式执业会员
资产评估师
蒋霄骑
31220008

正式执业会员
资产评估师
冯赛平
31200002

资产评估报告日: 2026 年 08 月 05 日

地址: 上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江中心 T3 座 7 楼

邮编: 200232

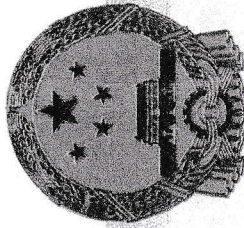
电话: 021-63081130

传真: 021-63081131

电子邮箱: contact@jzvaluation.com

附 件

- 附件一、 委托人和被评估单位营业执照
- 附件二、 委托人和相关当事人的承诺函
- 附件三、 资产评估机构法人营业执照副本
- 附件四、 资产评估机构备案文件或者资格证明文件
- 附件五、 签名资产评估师资格证明文件
- 附件六、 签名资产评估师的承诺函



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

913205823237703256 (1/1)

编号 320500666202310170010



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称 苏州威特半导体股份有限公司

类型 股份有限公司(上市)

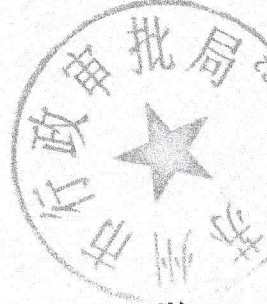
法定代表人 罗寅

经营范围 半导体分立器件、集成电路和系统模块的生产、设计、测试、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；软件开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本 7368.4211万元整

成立日期 2015年01月22日

住所 张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢01室



登记机关

2023年10月17日



营业执照

(副 本)

统一社会信用代码

91510100MA64PH581M



扫描经营主体信息码，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名称 晶艺半导体有限公司

注册资本 5333.411100万人民币元

类型 有限责任公司(港澳台投资、非独资)

成立日期 2019年01月03日

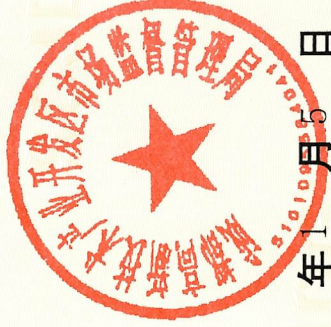
法定代表人 易坤

住所

中国(四川)自由贸易试验区成都高新区蜀锦路88号1栋2单元14层1403

经营范围 计算机系统集成;集成电路及模块、半导体器件专用设备、电子产品设计、研发、销售并提供技术服务、技术咨询、技术转让;货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

登记机关



2026年1月5日

扫描经营主体信息码

，了解更多登记、备案、许可、监管信息。

委托人承诺函

金证（上海）资产评估有限公司：

因苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买晶艺半导体有限公司100%股权事宜，特委托贵方对该经济行为所涉及的晶艺半导体有限公司股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构独立、客观、公正地进行资产评估，我方承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估所对应的经济行为符合国家规定；
2. 所提供的资产评估相关资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实地充分揭示；
3. 所提供的企业经营管理资料客观、真实、完整、合理；
4. 所提供的复印件或扫描件资料与原件相一致；
5. 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；
6. 纳入资产评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法、有效；
7. 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；
8. 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业；
9. 按照国家有关评估执业收费的规定支付评估费用。

委托人（盖章）：苏州锴威特半导体股份有限公司

法定代表人（签字）：



2026年8月5日

被评估单位承诺函

金证（上海）资产评估有限公司：

因苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买晶艺半导体有限公司100%股权事宜，苏州锴威特半导体股份有限公司委托贵方对该经济行为所涉及的我方股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构独立、客观、公正地进行资产评估，我方承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估所对应的经济行为符合国家规定；
2. 所提供的资产评估相关资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实地充分揭示；
3. 所提供的企业经营管理资料客观、真实、完整、合理；
4. 所提供的复印件或扫描件资料与原件相一致；
5. 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；
6. 纳入资产评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法、有效；
7. 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；
8. 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业。

被评估单位（盖章）：晶艺半导体有限公司

法定代表人（签字）：



2026 年 8 月 5 日

被评估单位承诺函

金证（上海）资产评估有限公司：

因苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买晶艺半导体有限公司100%股权事宜，苏州锴威特半导体股份有限公司委托贵方对该经济行为所涉及的我方股东全部权益价值进行评估。为确保资产评估机构独立、客观、公正地进行资产评估，我方承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估所对应的经济行为符合国家规定；
2. 所提供的资产评估相关资料真实、准确、完整、合规，有关重大事项如实地充分揭示；
3. 所提供的企业经营管理资料客观、真实、完整、合理；
4. 所提供的复印件或扫描件资料与原件相一致；
5. 纳入资产评估范围的资产与经济行为涉及的资产范围一致，不重复、不遗漏；
6. 纳入资产评估范围的资产权属明确，出具的资产权属证明文件合法、有效；
7. 纳入资产评估范围的资产在评估基准日至评估报告提交日期间发生影响评估行为及结果的事项，对其披露及时、完整；
8. 不干预评估机构和评估人员独立、客观、公正地执业。

For and on behalf of
HONG KONG LATTICE ART SEMICONDUCTOR CO., LIMITED
被评估单位（香港）：香港晶艺半导体有限公司

.....
Authorized Signature(s)

2026 年 8 月 15 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码

91320105674935865E

证照编号: 04000090202602275064

扫描经营主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息、体验更多应用服务。



名称 金证(上海)资产评估有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 林立

经营范围 一般项目: 资产评估; 房地产评估; 工程管理服务; 税务服务; 企业管理咨询; 财务咨询。(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

注册资本 人民币1300.0000万元整

成立日期 2008年07月15日

住所 上海市徐汇区龙兰路277号3幢7层

登记机关



2026年 02月 27日



单位会员证书

(电子证书)

评估机构代码：32020024

设立备案机关：省国资局

设立公函编号：苏国资评[2000]103号

设立公函日期：2000年01月31日



扫码查看详细信息

机构名称：金证（上海）资产评估有限公司

统一社会信用代码：
91320105674935865E

组织形式：有限责任公司

法定代表人：林立

注册资本：1,300.00 万元

办公场所：
上海市徐汇区龙兰路 277 号东航滨江
中心 3 号楼 7 楼 701、702 室

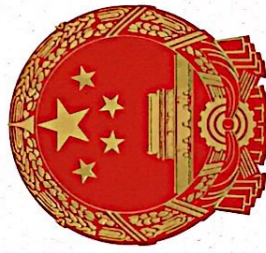
成立日期：2008 年 07 月 15 日

资产评估师数：56 人

年检信息：通过（2026 年）

有效期：2027 年 04 月 30 日





证券期货相关业务评估资格证书

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

江苏金证通资产评估房地产估价有限公司 从事证券、期货相关评估业务。

批准文号：财企[2009]38号 证书编号：0250053004

变更文号：财办资[2018]5号

序列号：000149

发证时间：





评估发现价值 诚信铸就行业

——评估精神

傍晚好! 今天是: 2026年08月01日 17:50:33 星期六

首 页 协会介绍 新闻报道 法规制度 资格考试 会员管理 债券研究 国

首页 - 新闻报道 - 要闻

金证（上海）资产评估有限公司位于下表中序号60

从事证券服务业务资产评估机构备案名单（截至2026年7月31日）

来源：财政部 发布时间：2026-07-31 浏览次数： 338

序号	资产评估机构名称	统一社会信用代码	备案公告日期
1	万邦资产评估有限公司	913302037200826149	2020/11/9
2	万隆(上海)资产评估有限公司	91310114132261800G	2020/11/9
3	上海东洲资产评估有限公司	91310120132263099C	2020/11/9
4	上海众华资产评估有限公司	913101041322063184	2020/11/9
5	上海申威资产评估有限公司	913101091329001907	2020/11/9
6	上海立信资产评估有限公司	91310104132265131C	2020/11/9
7	上海财瑞资产评估有限公司	91310114630203857P	2020/11/9
8	中京民信(北京)资产评估有限公司	91110108735198206U	2020/11/9
9	中发国际资产评估有限公司	91110108625900113M	2020/11/9
10	中和资产评估有限公司	91110101100017977P	2020/11/9
11	中威正信（北京）资产评估有限公司	91110106726376314T	2020/11/9
12	中水致远资产评估有限公司	91110108100024499T	2020/11/9
13	中瑞世联资产评估集团有限公司	91110102678011336A	2020/11/9
14	中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司	91440101673493815B	2020/11/9
15	中联资产评估集团有限公司	91110000100026822A	2020/11/9
16	中资资产评估有限公司	911101081000124554	2020/11/9
17	中通诚资产评估有限公司	91110105100014442W	2020/11/9
18	中铭国际资产评估（北京）有限责任公司	9111010267820666X7	2020/11/9
19	北京中企华资产评估有限责任公司	91110101633784423X	2020/11/9
20	北京中同华资产评估有限公司	91110102101880414Q	2020/11/9
21	北京中和谊资产评估有限公司	911101016782016748	2020/11/9
22	北京中天华资产评估有限责任公司	91110102700240857C	2020/11/9
23	北京中天和资产评估有限公司	91110102720918709G	2020/11/9
24	北京中天衡平国际资产评估有限公司	91110105718187476J	2020/11/9

25	北京中林资产评估有限公司	911101017817007896	2020/11/9
26	北京中科华资产评估有限公司	911101086782048917	2020/11/9
27	北京中锋资产评估有限责任公司	91110108600487959A	2020/11/9
28	北京亚太联华资产评估有限公司	911101027957154470	2020/11/9
29	北京亚超资产评估有限公司	91110108677404285F	2020/11/9
30	北方亚事资产评估有限责任公司	91110101MA001W1Y48	2020/11/9
31	北京华亚正信资产评估有限公司	91110105722612527M	2020/11/9
32	北京卓信大华资产评估有限公司	91110108746100470L	2020/11/9
33	北京国友大正资产评估有限公司	91110105633790321N	2020/11/9
34	北京国融兴华资产评估有限责任公司	91110102718715937D	2020/11/9
35	北京天健兴业资产评估有限公司	91110102722611233N	2020/11/9
36	北京天圆开资产评估有限公司	911101086662511648	2020/11/9
37	北京戴德梁行房地产土地资产评估有限公司	911101055808096225	2020/11/9
38	北京金开中天资产评估有限公司	91110102192288714W	2020/11/9
39	南京长城土地房地产资产评估造 价咨询有限公司	91320117339337219K	2020/11/9
40	厦门嘉学资产评估房地产估价有 限公司	9135020015502324XR	2020/11/9
41	同致信德（北京）资产评估有限 公司	911101057220973772	2020/11/9
42	嘉兴求真房地产资产评估有限公 司	91330483691292064Q	2020/11/9
43	四川天健华衡资产评估有限公司	915100002018151779	2020/11/9
44	国众联资产评估土地房地产估价 有限公司	91440300674802843P	2020/11/9
45	坤元资产评估有限公司	913300001429116867	2020/11/9
46	天津中联房地产土地资产评估有 限责任公司	91120116673724396E	2020/11/9
47	天津华夏金信资产评估有限公司	91120116675967199J	2020/11/9
48	天津国信资产评估有限公司	9112011667595702XU	2020/11/9
49	天源资产评估有限公司	9133000072658309XG	2020/11/9
50	安徽中联合国信资产评估有限责任 公司	9134010014904372X1	2020/11/9
51	山东正源和信资产评估有限公司	91370102677262969U	2020/11/9
52	广东中广信资产评估有限公司	91440000455925042T	2020/11/9
53	广东联信资产评估土地房地产估 价有限公司	91440000190357448H	2020/11/9
54	北京坤元至诚资产评估有限公司	91110108668556439X	2020/11/9
55	中盛华资产评估有限公司	91650100697819429R	2020/11/9
56	格律（上海）资产评估有限公司	91310120MA1HPLPR8W	2020/11/9
57	正衡房地产资产评估有限公司	9161013829423061XJ	2020/11/9
58	江苏中企华中天资产评估有限公 司	913204021371842774	2020/11/9
59	江苏华信资产评估有限公司	91320000134775637H	2020/11/9
60	金证（上海）资产评估有限公司	91320105674935865E	2020/11/9
61	沃克森（北京）国际资产评估有 限公司	911101087921023031	2020/11/9
62	浙江中企华资产评估有限公司	913300007125591955	2020/11/9
63	浙江中联资产评估有限公司	91330000758074863F	2020/11/9
64	深圳中联资产评估有限公司	91440300573136300E	2020/11/9
65	深圳市世联资产房地产土地评估 有限公司	91440300576874288Y	2020/11/9



66	深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司	914403007084267362	2020/11/9
67	深圳道衡美评国际资产评估有限公司	91440300715247197A	2020/11/9
68	湖北众联资产评估有限公司	914201061775704556	2020/11/9
69	福建中兴资产评估房地产土地估价有限责任公司	91350000158148072C	2020/11/9
70	联合中和土地房地产资产评估有限公司	913501007173080101	2020/11/9
71	辽宁众华资产评估有限公司	912102027234868923	2020/11/9
72	辽宁元正资产评估有限公司	912102042423804216	2020/11/9
73	连城资产评估有限公司	9111010810001651XW	2020/11/9
74	重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司	915001036761192206	2020/11/9
75	银信资产评估有限公司	9131000063026043XD	2020/11/9
76	青岛天和资产评估有限责任公司	91370200713709634P	2020/11/9
77	深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司	9144030075863033XE	2020/11/17
78	鹏翔房地产土地资产评估有限公司	91440300MA5EWDKB65	2020/11/17
79	广东惠正资产评估与房地产土地估价有限公司	91441302761558463D	2020/11/17
80	北京晟明资产评估有限公司	911101086869028683	2020/12/11
81	北京中天创意资产评估有限公司	91110105MA002B6E0E	2020/12/11
82	北京东审资产评估有限责任公司	91110102101142569G	2020/12/11
83	广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司	91440000190380779D	2020/12/11
84	河北立千资产评估有限责任公司	91130101674697692Y	2020/12/11
85	江苏天健华辰资产评估有限公司	91320105MA22FY2MXR	2020/12/11
86	深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司	914403007586258562	2020/12/11
87	新兰特房地产资产评估有限公司	91610000755235510N	2020/12/11
88	北京中致成国际资产评估有限公司	91110102678204103M	2020/12/11
89	山东中评恒信土地房地产资产评估有限公司	91370102689832113D	2020/12/31
90	山东中新土地房地产资产评估有限公司	913701046768310074	2020/12/31
91	北京仁达房地产土地资产评估有限公司	91110102722617723D	2020/12/31
92	北京同仁和资产评估有限责任公司	91110102718773029F	2021/1/15
93	北京合佳资产评估有限公司	91110105MA01DCRX32	2021/1/15
94	中兴华咨（北京）房地产评估工程咨询有限公司	911101027263771655	2021/2/8
95	北京华源龙泰房地产土地资产评估有限公司	9111010678250072X7	2021/2/8
96	北京市金利安房地产咨询评估有限责任公司	911101021012046006	2021/2/8
97	江苏普信资产评估房地产土地估价有限公司	9132021475898124T	2021/2/8
98	坤信国际资产评估集团有限公司	91370100MA3R83Q716	2021/2/8
99	深圳立信资产评估房地产估价有限公司	91440300695597279P	2021/2/8



100	深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司	9144030076499288XX	2021/2/8
101	深圳市同致诚德明资产评估有限公司	91440300680366339L	2021/2/8
102	深圳中企华土地房地产资产评估有限公司	91440300682040500T	2021/2/8
103	深圳亿通资产评估房地产土地估价有限公司	9144200066504987XM	2021/2/8
104	四川大友房地产土地资产评估有限公司	91510107725387089J	2021/2/8
105	宇威国际资产评估（深圳）有限公司	91440300MA5EMT2944	2021/2/8
106	中联资产评估集团（陕西）有限公司	91610000794134544E	2021/2/8
107	中瑞国际房地产土地资产评估有限公司	911101086337736017	2021/2/8
108	上海美评资产评估有限公司	9131010857411586XG	2021/3/5
109	山西中新资产评估有限公司	91140106110015748L	2021/3/29
110	深圳中科华资产评估有限公司	91440300MA5EY9G35B	2021/3/29
111	中天成土地房地产资产评估（北京）有限公司	91110105MA00EB4E39	2021/3/29
112	北京高力国际土地房地产资产评估有限公司	91110108MA00AWRQ32	2021/3/29
113	四川维诚资产评估有限公司	91510108794930268M	2021/3/29
114	浙江银信资产评估有限公司	91330205671207635U	2021/3/29
115	上海加策资产评估有限公司	913101096957745386	2021/3/29
116	上海城乡资产评估有限责任公司	91310118132244832R	2021/3/29
117	中联资产评估集团（青岛）有限公司	91370200740373830T	2021/4/23
118	北京嘉瑞国际资产评估有限公司	91110105693251602G	2021/4/23
119	中联资产评估集团山东有限公司	913701026772611495	2021/5/18
120	北京国枫兴华资产评估有限公司	91110102722601641G	2021/5/18
121	北京华鉴资产评估有限公司	91110107MA008R4N8L	2021/5/18
122	中立资产评估（北京）有限公司	91110105679601944G	2021/5/18
123	安徽华安资产评估事务所有限公司	91340100786521683R	2021/5/18
124	广东谷值资产评估有限公司	91440101347484382W	2021/5/18
125	安永资产评估（上海）有限公司	91310120631729711Y	2021/6/11
126	深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公司	91440300559870031A	2021/6/11
127	福建华成房地产土地资产评估有限公司	91350000158158123P	2021/6/11
128	广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司	914401137181791934	2021/7/15
129	和汛资产评估有限公司	91340221065200337A	2021/7/15
130	杭州禄诚资产评估有限公司	91330105MA28U3T04C	2021/7/15
131	天昊国际房地产土地资产评估集团有限公司	91370500752690956L	2021/7/15
132	北京大地资产评估事务所有限公司	913702006790650615	2021/7/15
133	中同华资产评估（上海）有限公司	91310118MA1JNQ6F3E	2021/8/20
134	上海集联资产评估有限公司	913101106306321332	2021/8/20
135	青岛德铭资产评估有限公司	91370202679056093T	2021/8/20



136	深圳君瑞资产评估所（特殊普通合伙）	91440300MA5GJDAK75	2021/9/23
137	北京公信评估有限公司	91110114327278047D	2021/9/23
138	北京中评正信资产评估有限公司	91110102MA001CNP69	2021/9/23
139	中联资产评估集团广西有限公司	91450103595139326E	2021/10/29
140	上海德勤资产评估有限公司	91310101MA1FP8YE17	2021/11/30
141	毕马威资产评估（上海）有限公司	91310106MA1FY2UH3J	2021/11/30
142	四川华坤房地产土地资产评估有限公司	915101055722581622	2021/11/30
143	中盛评估咨询有限公司	91320594MA22BH5F3Q	2021/11/30
144	北京富川房地产土地资产评估有限公司	91110101795954421R	2021/12/31
145	北京信诚资产评估有限责任公司	91110102634383066P	2021/12/31
146	上海科东资产评估有限公司	91310116MA1JADC96A	2021/12/31
147	重庆坤元资产评估有限公司	91500103MAABX2YN5J	2021/12/31
148	无锡桥一资产评估事务所（有限合伙）	91320213MA1X120F25	2021/12/31
149	中同华（广州）资产评估有限公司	91440101MA9XX9BD42	2021/12/31
150	华夏资产评估（北京）有限公司	91110105633723487L	2022/2/7
151	中勤资产评估有限公司	91110106062809171Q	2022/2/7
152	重庆汇丰房地产土地资产评估有限责任公司	91500103203315483T	2022/2/7
153	中联资产评估集团四川有限公司	91510100MA68NP6K0H	2022/2/7
154	北京芊海房地产土地资产评估有限公司	911101016900339928	2022/2/28
155	广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司	91440606280107071B	2022/2/28
156	中联资产评估集团河南有限公司	91410100MA3XE8EE4Q	2022/3/30
157	中全资产评估（北京）有限公司	91110108MA01QN3W3W	2022/3/30
158	湖北玖誉房地产评估有限公司	914206005971842192	2022/5/31
159	福州和道资产评估有限公司	91350103MA8UBHUL8X	2022/5/31
160	广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司	91440000722457192P	2022/6/30
161	江苏国衡中测土地房地产资产评估咨询有限公司	91320111MA22LP5H69	2022/6/30
162	河南正信联合资产评估事务所（普通合伙）	914101056659703516	2022/7/31
163	武汉财天下国际资产评估有限公司	91420106MA4L0Q2311	2022/9/30
164	洲蓝（上海）资产评估有限公司	91310000MA7MEE6J8F	2022/9/30
165	深圳市国策房地产土地资产评估有限公司	91440300192381740H	2022/9/30
166	重庆金汇房地产土地资产评估事务所有限责任公司	91500103750053160P	2022/10/31
167	上海富申国有资产评估有限公司	913101041322321297	2022/11/30
168	中联资产评估咨询（上海）有限公司	91310113MA1GPNWKXU	2023/2/28
169	江苏富华资产评估有限公司	913200006754533587	2023/2/28
170	嘉兴中磊资产评估有限公司	91330402785660921T	2023/2/28
171	重庆恒禾资产评估土地房地产估价有限公司	91500112MA5UFN235F	2023/2/28
172	深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司	91440300748859253X	2023/2/28



注：北京经纬仁达资产评估有限公司“未进行年度备案”。

分享：



网站管理：中评协对外宣传部 技术支持：中评协信息会员部
电子邮箱：it@cas.org.cn 邮编：100045
地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦16层
(自2005年8月1日起) 京ICP备2020034749号
中国资产评估协会版权所有，如需转载，请注明来源



欢迎关注财政部
官方微信公众平台



欢迎关注中评协
官方微信公众平台



上海市财政局

沪财资备案〔2026〕13号

关于金证（上海）资产评估有限公司 股东变更备案的公告

金证（上海）资产评估有限公司股东变更备案及有关材料收悉。根据《中华人民共和国资产评估法》《资产评估行业财政监督管理办法》的有关规定，予以备案。变更备案的相关信息如下：

金证（上海）资产评估有限公司股东发生变更，变更后的股东为蒋骁、林立、方明、徐晓斌、杨洁、谢佳妮、郭韵琨、李崇、郅建强、梁原、林骁、高诚、罗佳、李斌、陈蓓、潘霞、滕空、马翊君、蒋承玲、倪志君、陶毅俊、冯赛平、李雨勤、陈磊圣、刘怡青、管屹、钱焱伟、苏锐、夏智豪、孙岩、银川、鲍亚建、蒋霄骑和北京金证互通资本服务股份有限公司。

相关信息已录入备案信息管理系统，可通过中国资产评估协会官方网站进行查询。

特此公告。



信息公开属性：主动公开

抄送：财政部资产管理司，上海市资产评估协会。

上海市财政局办公室

2026年4月3日印发



中国资产评估协会 正式执业会员证书

会员编号：31220008

会员姓名：蒋霄骑

证件号码：210423*****0

所在机构：金证（上海）资产评估有限公司



年检情况：2026 年通过

职业资格：资产评估师

矿业权评估师



扫码查看详细信息

本人印鉴：



签名：

(Handwritten signature of Jiang Xiaoli)



(有效期至 2027-04-30 日止)



中国资产评估协会

正式执业会员证书

会员编号：31200002

会员姓名：冯赛平

证件号码：362532*****9

所在机构：金证（上海）资产评估有限公司



年检情况：2026 年通过

职业资格：资产评估师



扫码查看详细信息

本人印鉴：



签名：

冯赛平



(有效期至 2027-04-30 日止)

评估机构及资产评估师承诺函

苏州锴威特半导体股份有限公司：

受贵方委托，以 2026 年 02 月 28 日为基准日，金证（上海）资产评估有限公司组织资产评估师蒋霄骑、冯赛平等人，对苏州锴威特半导体股份有限公司拟发行股份及支付现金购买晶艺半导体有限公司 100% 股权所涉及的晶艺半导体有限公司股东全部权益价值进行了清查核实、评定估算评估，并形成了金证评报字【2026】A0554 号资产评估报告。在假设条件成立的情况下，我们承诺如下，并承担相应的法律责任：

1. 资产评估行为严格按照评估准则及规范性文件的要求进行；
2. 核实评估委托人提供的评估委托范围与资产占有方提供的资产范围相一致，不重复、不遗漏；
3. 对纳入资产评估范围的各类资产按规定进行合理的抽查、核实，没有发现问题；
4. 评估方法选用经过相关性分析，恰当、合理，选用依据充足；
5. 选用的参数、数据、资料等权威、可靠，修正因素考虑得当，可以充分发挥技术支撑的作用；
6. 影响资产评估价值的主要因素考虑周全，没有遗漏；
7. 资产评估价值公允、计算准确；
8. 资产评估工作规范的完成所有程序；
9. 资产评估工作独立进行，未受任何人为干预；
10. 接受评估行政主管部门对评估工作的监督检查。

承诺人：蒋霄骑、冯赛平

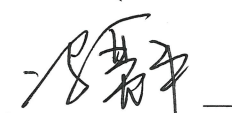
金证（上海）资产评估有限公司
(资产评估机构印章)





(资产评估师印章并签字)





(资产评估师印章并签字)





(评估机构法定代表人签字)

二〇二六年八月